P6/P7

S C H A L T B I L D E R

NEC

NEC 433270-002 C 1/2

NOTE 1. STAMP PCB REV AND LOT NO WITH WA 2943 # 14 (BLACK).

NOTE 2. MOUNTING OF (31)

NOTE 3. MOUNTING OF (31) (SENSOR ASSEMBLY)

NOTE 4. COMPONENT MOUNTING IN AREA A.

NOTE 5. CAUTION REQUIRED HANDLING OF MOS IC.

SYMBOL	CONSTRUCTION SPECIFICATION
1G.1K.1M.3C.3F.4M.5B.5C.5E 5F.5G.7B.7C.7E.7F.7G	ENI-120009

HIGHT: 11 mm MAX.

MS 1 AND 2 ARE EXCLUDED.

NOTE 6. SYMBOL + REPRESENTS BASIC GRID 2.54 mm AND SYMBOL • SECOND GRID 0.508 mm.

SEE NOTE 8

BOARD

CAUTION REQUIRED FOR HOMING PROCESS

AFTER MOUNTING THE BOARD, FIX IT WITH ALTECO.

BOTTOM MUST BE ADHERED CLOSELY TO THE BOARD.

SEE NOTE 1

AFTER SOLDER DIPPING CUT OFF.

G9WZMB
136-433270-002 REV
NEC MADE IN JAPAN
NEC-14
P6/P7 DRIVER AND LOGIC PCB LOT NO
PROGRAM FIRMWARE
© 1985, NEC Corporation

1 COLOR UNIT 1 | 9 DC INPUT 1 | 5V 5V SG DG 34V

CN7 CN9 CN8 FAN

CN4 SP MOTOR LF MOTOR

CN3

CN10 OPERATOR PANEL

CN1 CN2

1M 2764(300)
2M 74LS373
3M 74LS138
4M μPD78104
5M 74LS139
6M 2406
1C 7404
1B 7404
2C 74S05
2D 74S05
2E 74LS08
3C μPD78104
3E 74LS05
3F 8255A-5
4C 74LS373
4E 74LS373
5B 74LS32
5C μPD4168C-20
5E μPD4168C-20
5F μPD4168C-20
5G μPD4168C-20
6C PROM 27256(EW)
6E PROM 27256(EW)
6F PROM 27256(EW)
6G PROM 27256(EW)
6J 74LS20
6K 74LS04
6L 74LS32
7B 74LS05
7C PROM 27256(EW)
7E PROM 27256(EW)
7F PROM 27256(EW)
7G μPD4168C-20
8B 7407
8E 74LS05
8F 74LS05
8G 74LS05
8H 74LS05
1G 8255A-5
1H 74LS04
1J 74LS00
1K 8253-5
SA 74LS30
SB μPD4168C-20
SC μPD4168C-20
SE μPD4168C-20
SF μPD4168C-20
SG μPD4168C-20
SH 74LS139
SJ 74LS375
SK 74LS04
SW1
SW2
SW3
LED
SENSOR
RM1
RM2
RM3
RM4
RM5
RM6
RM7
RM8
RM9
RM10
RM11
RM12
RM13
DM1
DM2
DM3
DM4
DM5
CN6
CM1
CM2
-X1-
BZ1
BZ2
MS1
MS2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17
Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q41 Q42 Q46
R32 R33 R40
X1 X2

NOTE 9. C72, C74, C75, J1 AND J2 HAVE NO MOUNTING PARTS (WITH MARKING).

NOTE 8. (31) MUST BE MOUNTED BY HAND SOLDERING OR BY DIP SOLDERING. IN LATER CASE, FLUX PK CONNECTOR MUST BE REMOVED WITH 1,1,1-TRICHLOROETHANE. AFTER MOUNTING BE SURE (31) IS SEATED TIGHTLY ON BOARD.

NOTE 7. THESE PARTS MUST NOT BE WASHED WITH 1,1,1-TRICHLOROETHANE

PARTS ITEM NUMBER
50.86.87.94

31 COMPONENT MOUNTING
HOLE PATTERN DRAWING
PARTS LIST

改行	年月日
1	
2	
3	
4	
5	

1	A	1985.4.8	
2	A	1985.8 SC-5052	
3	B	1985.10	
4	C	1985.11.26 SC-5071781	

P6/P7

時に指定なき寸法公差はNIS公差による

THIS DRAWING
SA-433270-002
SA-433270-002
SA-433270-002
SA-433270-002
SA-433270-002
SA-433270-002
SA-433270-002

BOTH

ELM-GF
Au(—u), Ni-Au(—u)
Cu( ), のっき
ソルダーレジスト
フラックス

G9WZMB
COMPONENT MOUNTING
136-433270-002-C
JAP SHT 1/2

フィルム
A.P. ROLL
整理対照
整理番号

ADS-A1-0808

E36-433270-002-C 2/2

改訂年月日
1
2
3
4
5

ITEM	SYMBOL	PARTS NAME	DESIGNATION		UNIT	QTY.
1		SPWZMB PCB	P	E36-433270-002-D	P	1
2						
3						
4						
5	IC.10	7404	P	E808-905009-001-A	P	2
6	2C.2D	7405	P	E808-905005-001-A	P	2
7	6H	7406	P	E808-905006-001-A	P	1
8	8D	7407	P	E808-905007-001-A	P	1
9	1J	74LS00	P	E808-907000-001-A	P	1
10	1H.5K	74LS04	P	E808-907004-001-A	P	2
11	8B.8C.8E.8F.8G.8H	74LS05	P	E808-907005-001-A	P	6
12	2E	74LS08	P	E808-907008-001-A	P	1
13	6J.6K	74LS20	P	E808-907020-001-A	P	2
14	5A	74LS30	P	E808-907030-001-A	P	1
15	6L	74LS32	P	E808-907032-001-A	P	1
16	3H	74LS138	P	E808-907138-001-A	P	1
17	5M	74LS139	P	E808-907139-001-A	P	1
18	2M.9G	74LS373	P	E808-907373-001-A	P	2
19	9G	74LS379	P	E808-907379-001-A	P	1
20	5J	74LS375	P	E808-907375-001-A	P	1
21	9B	μPC277C	P	E808-919202-771-A	P	1
22	9C.9M	μPD7810G	P	E808-919902-001-A	P	2
23	1K	8255-5	P	E808-919322-002-A	P	1
24	1G.3F	8255A-5	P	E808-919323-001-A	P	2
25	5B.5C.5E.5F.5G.7G	μPD9168C-20	P	E802-140115-020-A	F	6
26	1M	PROM2764(1) REWORK	A	E136-202189-002-A	S	1
27	7B	PROM27256(1) REWORK	A	E136-202188-002-A	S	1
28	7C.7E.7F	PROM27256(3) REWORK	A	E136-201633-001-A	S	1
29						
30	Q26.Q27.Q30.Q31	2SB974	P	E808-922014-001-A	P	9
31	Q5.Q9.Q13.Q17 Q21.Q42.Q44.Q53	2SB1098	P	E802-260074-101-A	P	8
32	Q22~Q25.Q28.Q29.Q32.Q33	2SD1308	P	E808-922015-001-A	P	8
33	Q6~8.Q10~12.Q14~16.Q18~20 Q34~Q40.Q43~Q46.Q47~Q49 Q50~Q52	2SD1163	P	E802-260075-101-A	P	24
34	Q1.Q3.Q4	2SA1152-T	P	E802-250030-001-D	P	3
35	Q2.Q54~Q57	2SC2718-T	P	E802-250030-002-D	P	5
36	Q21	2SD1286	P	E808-922017-001-A	P	1
37						
38						
39	OM1~OM5	μPA552H	P	E808-910000-542-A	P	5
40						
41						
42	CS-D20.D22~D25.D30~D33 D37~D41.D55~D58	T-GDA200VIA	P	E802-210019-101-A	P	20
43						
44						
45	D2.D21.D26~D29 D33~D37	1S953	P	E808-923009-541-A	P	10
46	D3.D4	RD2.7EB1	P	E808-923502-047-A	P	2
47	D55~D62	RD22FB	P	E808-923605-265-A	P	8
48						
49						
50	LED	SN7138	P	E802-810020-002-A	P	1
51						
52						
53	RM7.RM8	IHR-1/8-8-471JA	P	E808-930349-103-A	P	2
54	RM2.RM6.RM9	IHR-1/8-8-512JA	P	E808-930349-013-A	P	3
55	RM1.RM3~RM5	IHR-1/8-8-102JA	P	E808-930349-010-A	P	3
56	RM10~RM13	IHR-1/8-8-752JA	P	E808-930349-014-A	P	4
57	RM5	IHR-1/8-8-681JA	P	E808-930349-004-A	P	1
58						
59	R70.R71	T-RF07Q8321G	P	E808-930300-057-A	P	2

ITEM	SYMBOL	PARTS NAME	DESIGNATION		UNIT	QTY.
60	R66	T-RF07Q681G	P	E808-930300-056-A	P	1
61	R1.R25	T-RF07Q272G	P	E808-930300-063-A	P	2
62	R5	T-RF07Q563G	P	E808-930300-020-A	P	1
63	R2.R3	LF1/4 105G	P	E208-930300-074-A	P	2
64	R33	ERG3SJ/2IP	P	E802-310051-548-A	P	1
65	R49.R50	T-ERG1SJ101B	P	E802-310053-276-A	P	2
66	R91.R92	T-ERG1SJ7508	P	E802-310053-272-A	P	2
67	R9.R85.R67.R72	T-RF07Q562G	P	E808-930300-045-A	P	4
68	R60	T-RF07Q331G	P	E808-930300-008-A	P	1
69	R7.R9.R11.R22.R65.R68.R70 R90.R93.R59.R62.R63	T-RF07Q511G	P	E808-930300-076-A	P	12
70	R12.R16	T-RF07Q621G	P	E808-930300-023-A	P	2
71	R6.R8.R10.R23.R71 R89.R66.R61.R64	T-RF07Q222G	P	E808-930300-062-A	P	9
72	R43.R43.R44.R46.R47 R50.R53.R55.R56	T-RF07Q332G	P	E808-930300-012-A	P	9
73	R21	T-RF07Q203G	P	E808-930300-017-A	P	1
74	R29.R27.R30.R35.R38	T-RF07Q103G	P	E808-930300-015-A	P	5
75	R14.R15.R18.R19	T-RF07Q101G	P	E808-930300-038-A	P	4
76	R11.R34	T-RF07Q102G	P	E808-930300-010-A	P	2
77	R69.R58	T-RF07Q513G	P	E808-930300-071-A	P	2
78	R32.R40	ERX3SJR30P	F	E802-310051-548-A	P	2
79	R28.R37	T-RF07Q473G	F	E808-930300-041-A	P	2
80	R26.R39	T-RF07Q100G	P	E808-930300-029-A	P	2
81	R68.R69	ERG3SJ102U	P	E802-310051-605-A	P	2
82	C73	T-CK45B471KS0V	P	E808-935504-002-A	P	1
83	C55	MC01CH1H392K	P	E808-935501-031-A	P	1
84	C58.C50.C53.C52.C64 C57.C67.C69~C70	T-CK45B102KS0V	P	E808-935504-006-A	P	9
85	C1~C27.C29.C38.C31.C59~C61 C37~C39.C45~C63.C66.C68.C71	T-MC02F1H104Z	P	E808-935500-002-A	P	22
86	C1~C12.C58	T-CEK16V22UF	P	E808-935309-111-A	P	13
87	C13~C15	T-CEK50V22UF	P	E808-935300-101-A	P	3
88	C62.C65	T-MC02C1H562K	P	E808-935502-003-A	P	2
89	C28.C31.C32~C36 C40~C44.C52.C56	TPD47Y5V/16S5Z5-W	P	E808-935505-001-A	P	14
90	CM1.CM2	CSC300K	P	E808-970112-051-A	P	2
91						
92						
93	X1.X2	CSA7.0MT	P	E808-970112-003-A	P	2
94						
95						
96	OLY	ADL12-25	P	E809-920103-001-A	P	1
97						
98						
99	MS1.MS2	~~A537~~ SENSOR ASSEMBLY	A	E36-750310-001-A	P	2
100						
101						
102	SW1.SW2.SW3	DIP-SW	P	E808-950358-018-A	P	3
103						
104						
105	L1~L10	BL02RN1-R62T2	P	E808-920802-001-A	P	10
106						
107						
108	LM1.LM2	D-05N1	P	E808-970212-001-A	P	2
109						
110						
111						
112	IC.7E.7F.1M.7B	28PIC SOCKET SN	P	E808-955157-128-A	P	5
113						
114						
115						
116	CN1.CN2	21F-222	P	E802-720008-022-00	P	2
117	CN3	C107-2009	P	E808-955209-026-A	P	1
118	CN4	C106-2009	P	E808-955209-025-A	P	1

ITEM	SYMBOL	PARTS NAME	DESIGNATION		UNIT	QTY.
119	CN5	C105-2009	P	E808-955209-024-A	P	1
120	CN6	C102-2009	P	E808-955209-021-A	P	1
121	CN10	C105-1009	P	E808-955209-004-A	P	1
122	CN9	PEH-109	P	E802-710200-109-00	P	1
123	CN11	29-1.27DS. ~~DS1017~~	P	E808-955276-134-A	P	1
124	CN7	C111-2004 (HIROSE ELECTRIC CO., LTD.)	P	E808-955209-030-A	P	1
125						

版数	Issued	年	月	承認
1	A	1985	8	
2	A	1985	8	
3	B	1985	10	
4	C	1985	11	

HOLE PATTERN DRAWING

COMPONENT MOUNTING

承認	作図
	9/4

物に指定なき寸法公差はNIS公差による

基	基板(表1面)基パターン面	E36-433270-002
準	基板(裏1面)基パターン面	E36-433270-002
面	基板(表2面)基パターン面	E36-433270-002
	基板(裏2面)基パターン面	E36-433270-002
	部品面マーキング図	E36-433270-002
	※印面マーキング図	
	部品面ソルダーレジスト図	E36-433270-002
	※印面ソルダーレジスト図	

PARTS LIST THIS DRAWING

モールディング文字	1	表	
	2	裏	
	12	※印面シルクの有	
	12	※印面IWA-2943 R1	
マーキング文字	12	※印面シルクの有	
	12	※印面IWA-2947 R1	
	12	※印面ユニーク文字	

基準	表	裏	
仕上げ及びコート	全面基板	のっき	
処理	ソルダーレジスト	みどり色	
	フラックス	無	

設計基準	
端子仕様書	
基本端子	
最小導体幅	
最小導体間隔	

記号	ランド径	穴径	穴数	不良
ランド径及び穴径				

尺度	2/1	1/1	
投影法	第三角法		
図面の種類	基板図		
図番	136-433270-002-C		

パッケージ名称 G0WZMB

名称 PARTS LIST

図番 136-433270-002-C

JAP SHT 2/2

フィルム
AP ROLL
整理期限
整理番号

NEC 日本電気株式会社

NEC MADE IN JAPAN
NEC-14
G9WZMB
36-433270-002 REV1
P6/P7 DRIVER AND LOGIC PCB
PROGRAM FIRMWARE
©1985, NEC Corporation
LOT NO.
MADE MANUFACTURER
UL QUALIFICATION NUMBER
MARK ␣ REPRESENTS SPACE FOR THREE CHARACTERS.
(MARK ␣ DRAFTING IS NOT NEEDED.)
1: COLOR UNIT
2: DC INPUT
5V 5V SEL DC 34V
SENSOR
FAN
SP MOTOR
LF MOTOR
OPERATOR PANEL
1A
2C
3C (MASTER)
4M (SLAVE)
7B WZM7B
7C P24CG1
7E P24CG2
7F P24CG3
MOS*IC*USE
WZM1M
COMPONENT MOUNTING
HOLE PATTERN DRAWING
NOTES:
1. CHARACTER SIZE MUST BE WA-2943 #19 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
2. MARK * SHOWS THAT DRAFTING IS NOT REQUIRED.
3. MARK ○ SHOWS THAT DRAFTING IS REQUIRED WITH φ2.5 (SCALE: 4/1).
WA-2943 #19 (WHITE FRAME)
MARK * REPRESENTS SPACE FOR ONE CHARACTER.
G9WZMB MARKING FACE
36-453270-002-D
NEC 日本電気株式会社

136-453270-002-D 3/3

発行	
版	年月日
1	
2	
3	
4	
5	

136-453270-002-D-4

変更記号	版	年月日
1	A	1985.4.8
2	B	1985.7.26
3	C	1985.10.25
4	D	1985.11.21

COMPONENT MOUNTING
HOLE PATTERN DRAWING
NC DRIL

2-2.05 (GENERAL HOLE)

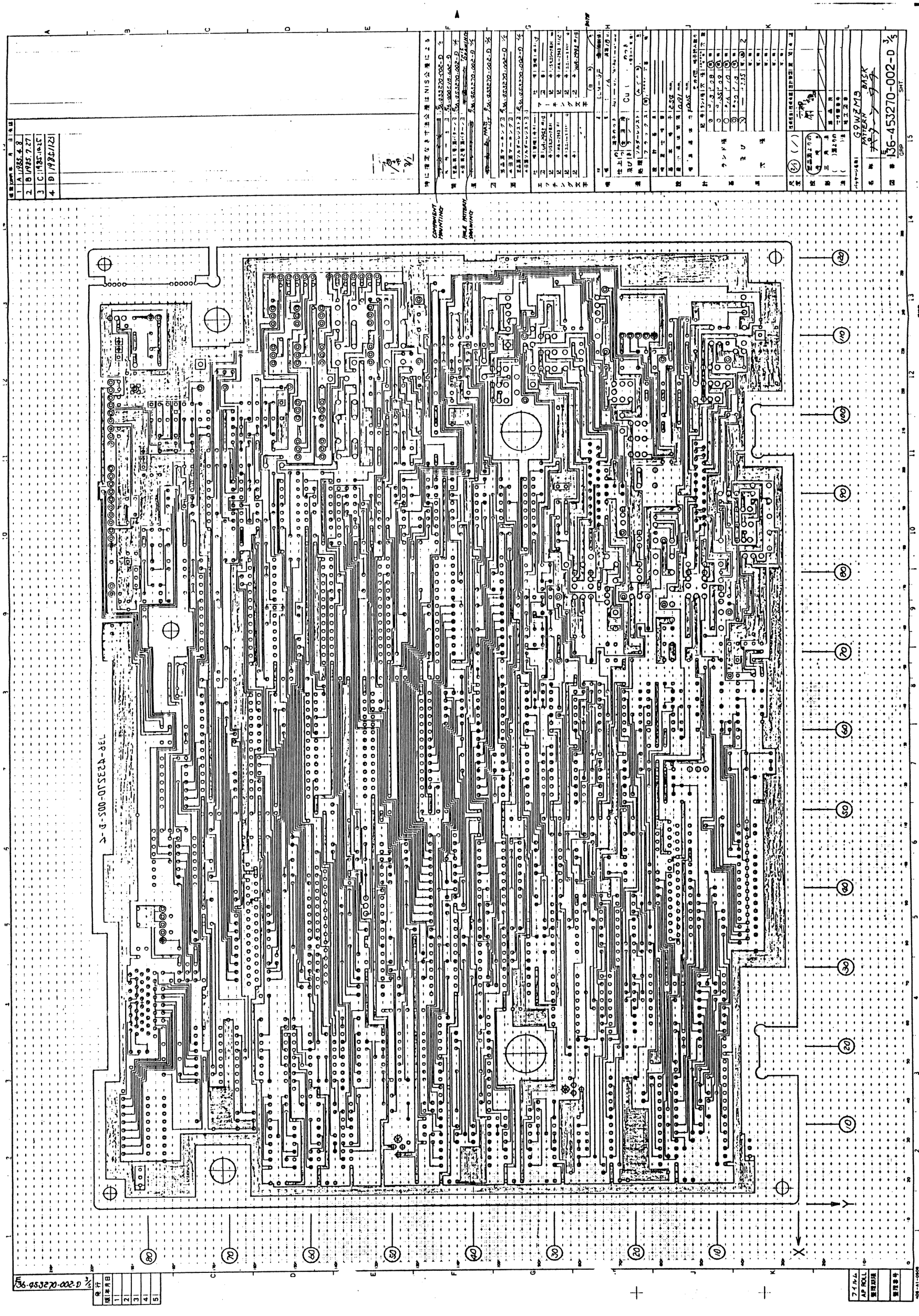
(for ICT) 2-φ4.4±0.05 THROUGH-HOLE PLATING IS NOT NEEDED.

X
Y

フィルム	
AP ROLL	
整理期限	
整理番号	

名称	G9WZMB PATTERN FACE パターンオモテ
図番	136-453270-002-D
	GRP SHT 1/4

NEC 日本電気株式会社


136-453270-002-D
X
Y

E36-453270-002-D 5/5

NOTES:
1. THROUGH-HOLE LAND MASKING IS AS SHOWN IN THE LEFT TABLE.
2. 2-φ2.05 (GENERAL HOLE) MASKING DIAMETER MUST BE φ3.05 FOR BOTH FACE AND BACK.
3. MASKING POSITION FOR LAND 13 SHOWN IN FACE AND BACK DRAWINGS.
4. "A" IN THIS DRAWING IS THE LAT STAMP AREA (BACK ONLY).
5. MASKING RELIEF IN HATCHED AREA IN THIS DRAWING IS REQUIRED FOR BACK ONLY.

LAND DIA.	MASKING DIA. FACE	MASKING DIA. BACK
φ1.3	φ1.9	φ1.6
φ1.35	φ1.35	φ1.55
φ1.6	φ1.6	φ2.0
φ2.0	φ2.0	φ2.4

BACK ONLY
SEE NOTE 4

エ.1. スルホールランドに対するマスキングは片面による。
2. 2-φ2.05(一般穴)のマスキング径はスモークウラ共にφ3.05とする。
3. ランドにまたがるマスキングエリアは基板のメタライゼーション形状による。
4. 図中 "A" はロット捺印エリア(ウラのみ)
5. 本図中 斜線部のマスキング 逃げは ウラのみとする。

改訂	年月日
1	1985.4.8
2	1985.7.26
3	1985.10.25
4	1985.11.21

原田 8/1

特に指定なき寸法公差はNIS公差による

	部品名称	図番
	COMPONENT MOUNTING	36-933270-002-D 4/5
基	外形寸法	36-900598-002-D
基	部品(第1層)面パターン	36-933270-002-D 3/5
基	半田(第2層)面パターン	36-933270-002-D 4/5
基	HOLE PATTERN DRAWING	36-933270-002-D 5/5
図	MARK ON CAST	36-933270-002-D 5/5
図	部品面マーキング(2)	36-933270-002-D 1/5
図	半田面マーキング(2)	
図	部品面ソルダーレジスト(2)	THIS DRAWING
図	半田面ソルダーレジスト(2)	

エッチング文字: 地 領域 号 1/—; 記 号 WA-2943 #1/2; 記 号 JIS丸ゴシック系 M; 記 号 WA-2943 #1; 記 号 ユニバース55H 4; 記 号
マーキング文字: 地 領域 号 1.5; 記 号; 記 号 JIS丸ゴシック系 M; 記 号 WA-2943 #1/2; 記 号 ユニバース55H 4; 記 号 WA-2943 #2

材質: ミルーGF
板厚: 1.6 調整 1.8 mm
仕上及び処理: めっき 端子めっき Au(— μ), Ni-Au(— — μ); 全面 ランド Cy( ) めっき; ソルダーレジスト みどり(光), ( ); フラックス(有), 種類 , 塩
設計基準
導体仕様
基本格子 2.54 mm
最小導体幅 mm
最小導体巾 mm

記号	ランド径	穴 径	穴 数
			有, 無

ランド径及び穴種

尺度 5/1 (/)
投影 図品面よりの 角度 三角法 部品面 面よりの 仕様書寸法 加工記事
パッケージ名称 G9WEMB
名称 MASKING AREA DRAWING マスキングエリア図
図番 36-453270-002-D 5/5
QAP SHT

フィルム
AP ROLL
整理期限
整理番号

A05-A1-0508

E36-453270-002-D 5/5

改訂	年月日
1	
2	
3	
4	
5	

改訂	年月日	承認
1	A 1985.4.8	
2	B 1985.7.26	
3	C 1985.10.7	
4	D 1985.11.21	

REFERENCE POINT (ON GRID)

REFERENCE POINT

REFERENCE POINT (ON GRID)

67

5.08

2.54

1.27

2.54

7×2.54=17.78

8×2.54=20.32

10×2.54=25.4

9×2.54=22.86

206.375

19.05

REFERENCE POINT

1.27

2.54

5×2.54=12.7

2.54

31×1.27=39.37

37

1.27

1.27

REFERENCE POINT

1.25

70

21×1.25=26.25

REFERENCE POINT (ON GRID)

21×1.25=26.25

REFERENCE POINT (ON GRID)

REFERENCE POINT (ON GRID)

REFERENCE POINT (ON GRID)

3.5

1.25

3×1.25=3.75

6×2.5=15

3×2.5=7.5

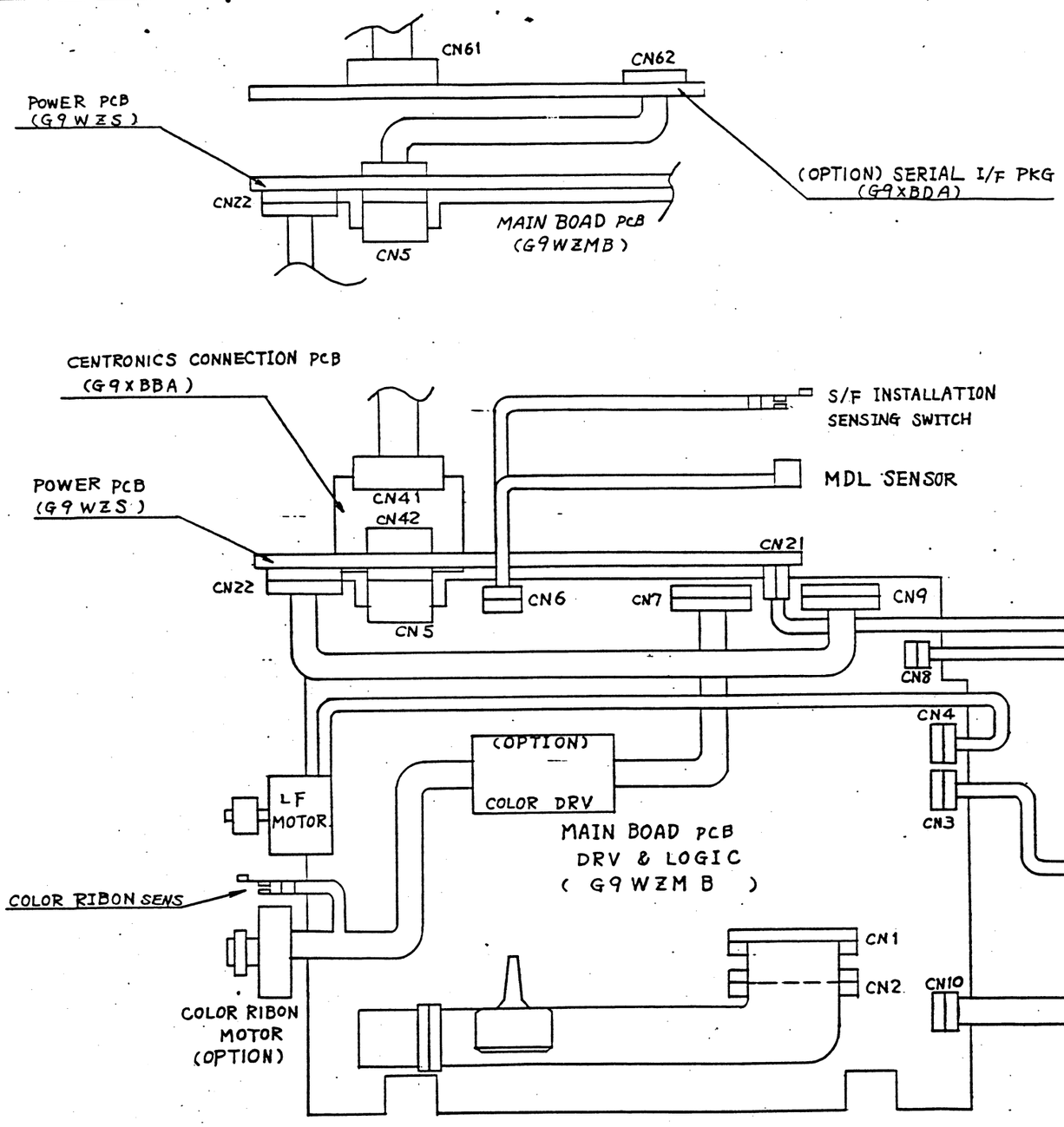
REFERENCE POINT (ON GRID)

3.81

3.81

3.81

136-100875-020-A



REV	COMP	DESCRIPTION(SC)	APP
1	A	1985.10.3	

DWG ABBR	
PKG LOCATION	
PKG NAME	
NEXT SPEC	

DRAFT	ENG	CHK	APP	ISSUE
松枝	宗		竹村	

CABLING DIAGRAM

(1/3)

136-100875-020-A

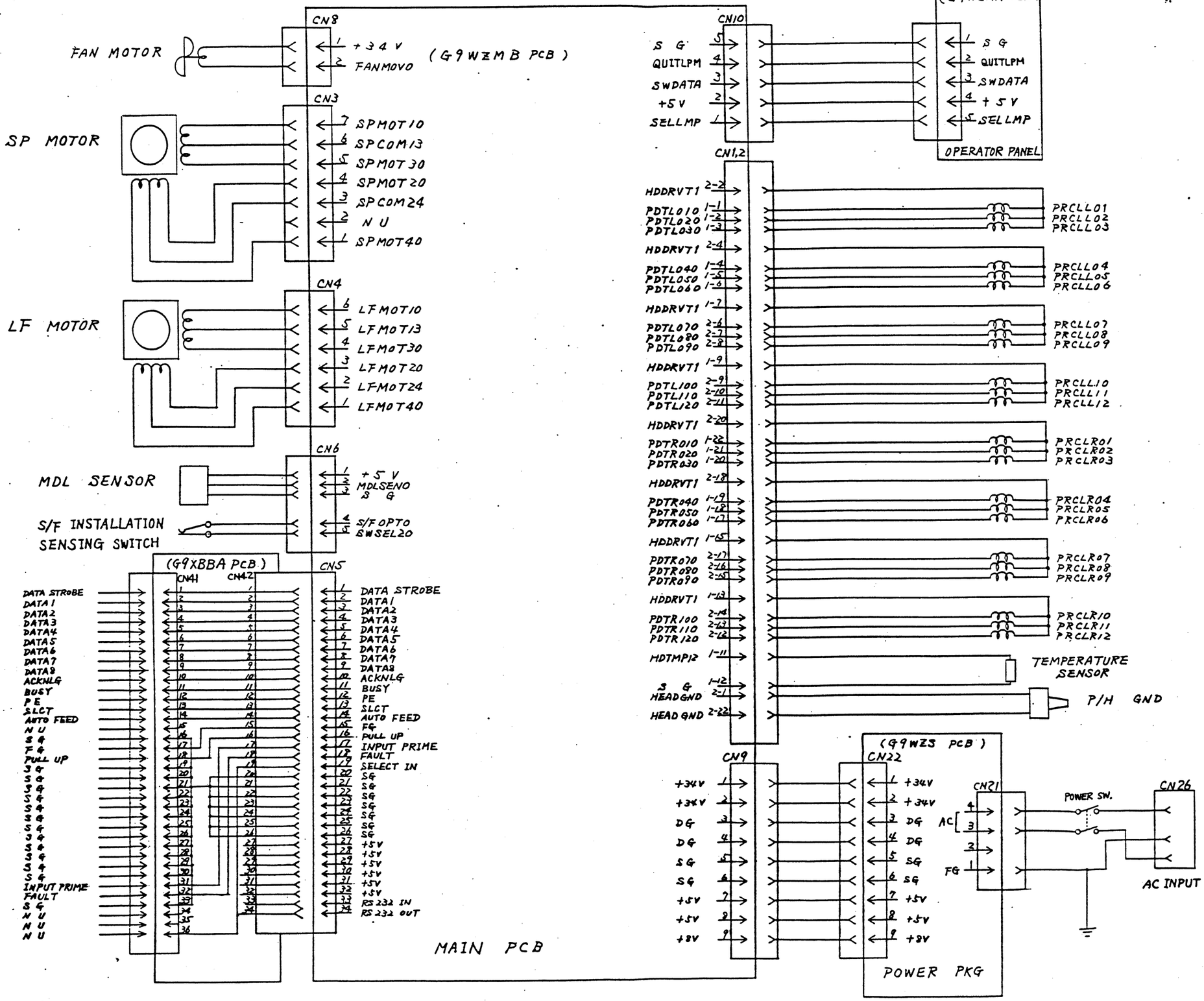
NEC SHT 1/1

EQUIP
Pinwriter P6/P7

DB-413-3E

Nippon Electric Co.,Ltd.

REV	COMP	DESCRIPTION (SC)	APP
1	A	1985. 10	—



DWG ABBR	
PKG LOCATION	
PKG NAME	
NEXT SPEC	

DRAFT	ENG	CHK	APP	ISSUE
松枝	上原		竹村	

CABLING DIAGRAM

(2/3)

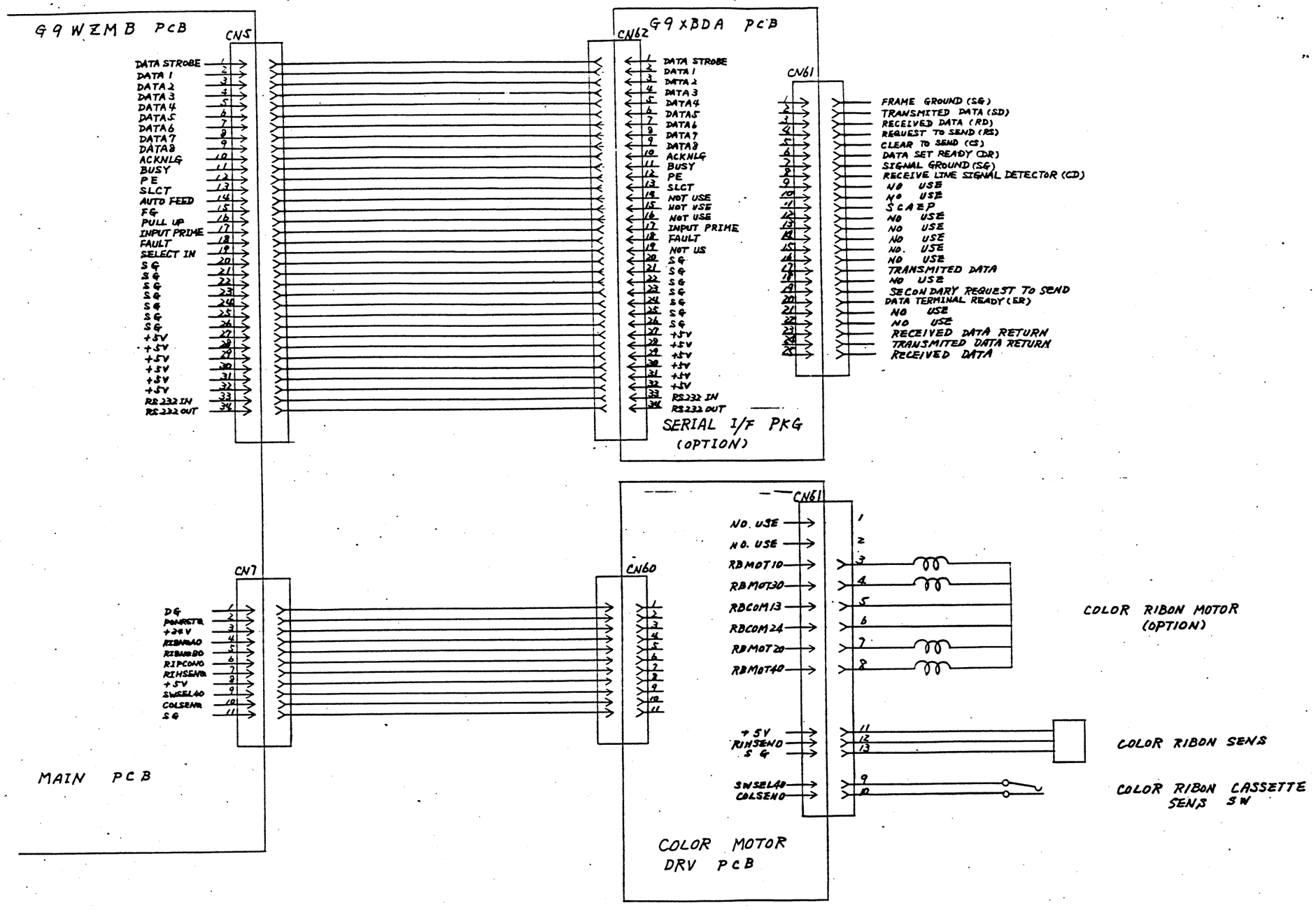
(STANDARD)

136-100875-021-A

NEC SHT 1/1

Nippon Electric Co Ltd

EQUIP
Pinwriter P6/P7



REV	COMP	DESCRIPTION (SC)	APP
1	A	'85.10.	

DWG ABBR	
PKG LOCATION	
PKG NAME	
NEXT SPEC	

DRAFT	ENG	CHK	APP	ISSUE
松枝	上原		町村	

CABLING DIAGRAM (3/3)

(OPTION)

136-100875-022-A

NEC SHT 1/1

Nippon Electric Co.,Ltd.

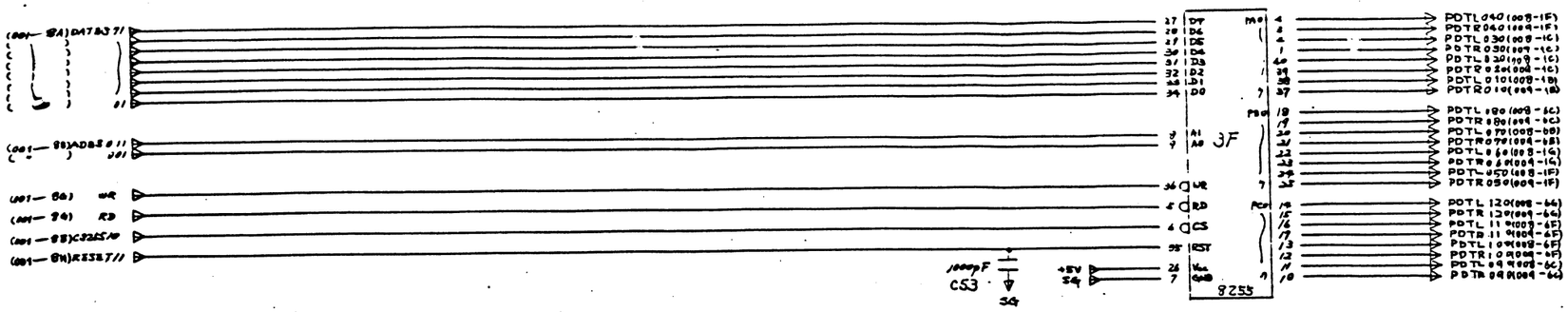
136-100875-022-A

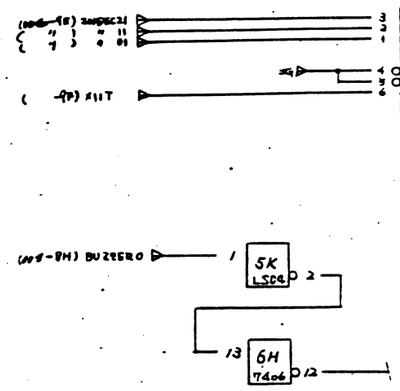
EQUIP

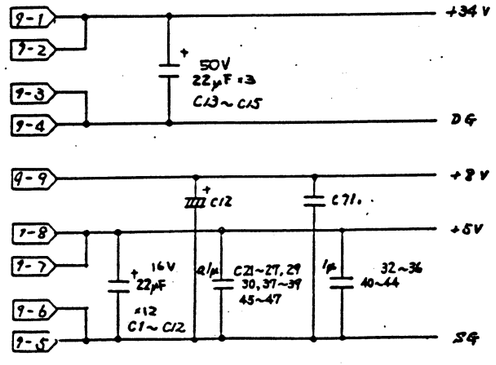
Printer P6/P7

136-443270-002-C

REV	COMP	DESCRIPTION (SC)	APP
1	A	1985. 3.15	
2	B	1985. 8.30	
3	C	1985. 11. 6	







Note. SW4 is not installed.
It's reserved for future use.

DWG ABBR	
PKG LOCATION	
PKG NAME	G9WZMB
	(002)
NEXT SPEC	

DRAFT	ENG	CHK	APP	ISSUE

G9WZMB PKG
Circuit Diagram

(DC. Input
DIP Switch
Print Data Latch)

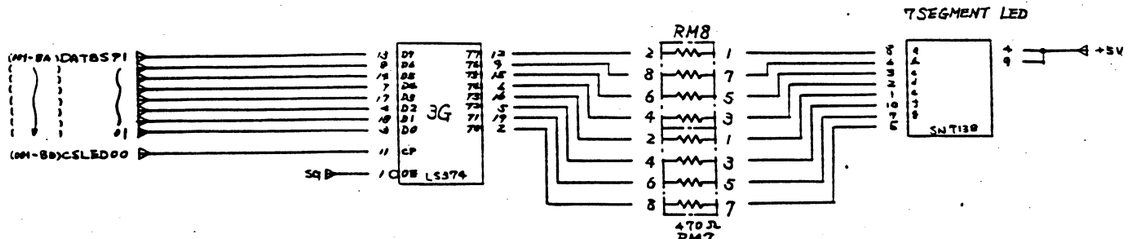
136-443270-002-C

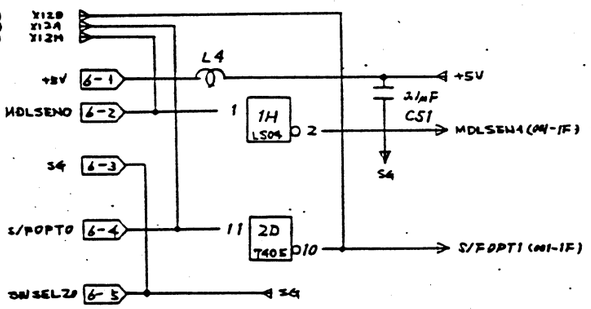
NEC SHT 2/

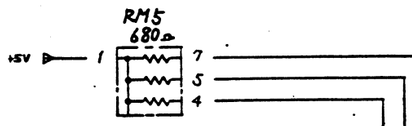
EQUIP
P6/P7

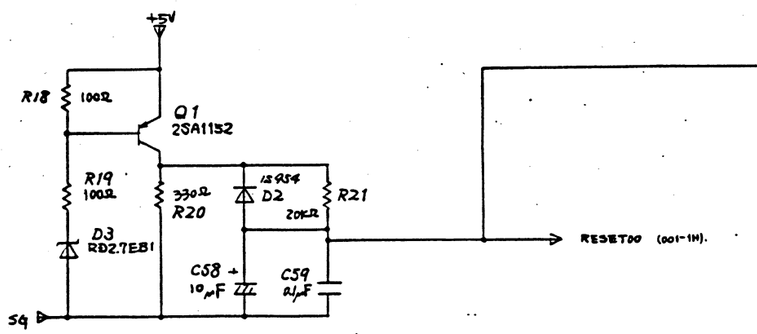
136-443270-002-C

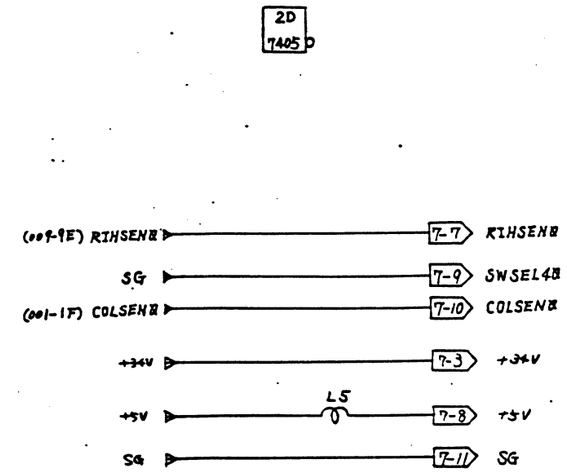
REV	COMP	DESCRIPTION (SC)	APP
1	A	1985. 3.15	
2	B	1985. 8. 30	
3	C	1985.11. 6	

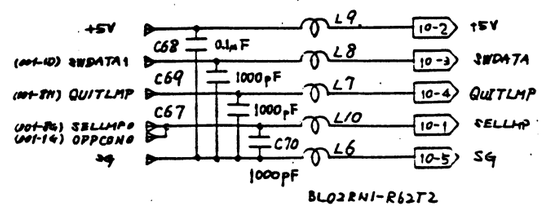












DWG ABBR	
PKG LOCATION	
PKG NAME	G9WZMB
	(003)
NEXT SPEC	

DRAFT	ENG	CHK	APP	ISSUE
	山川			

G9WZMB PKG
Circuit Diagram

(Color Driver Interface
Operator Panel Interface
Sensor Interface)

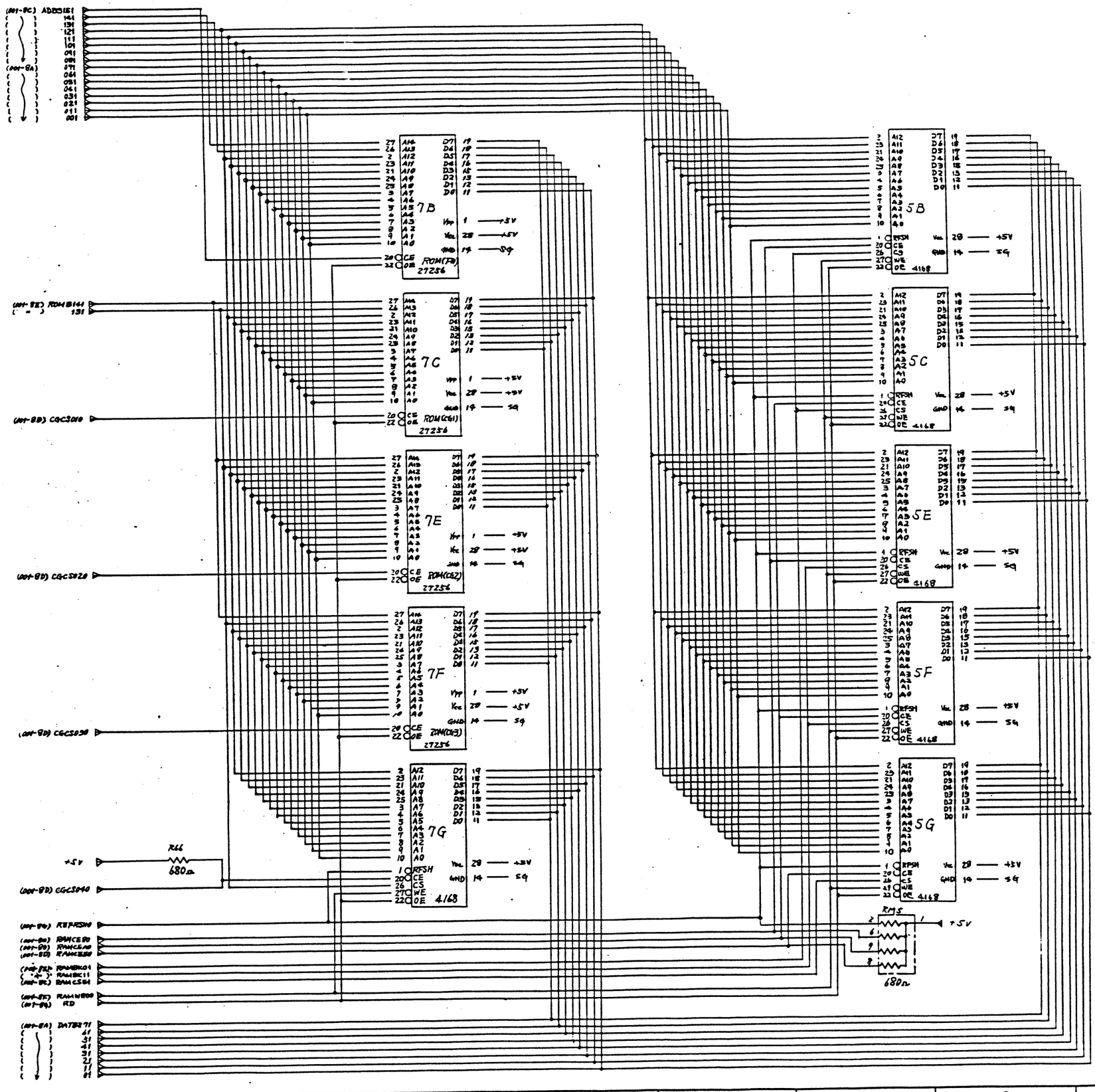
136-443270-002-C

NEC SHT 3/

EQUIP
P6/P7

136-443270-002-C

REV	COMP	DESCRIPTION(SC)	APP
1	A	1985. 3.15	
2	B	1985. 8.30	
3	C	1985. 11. 6	



DWG ABBR	
PKG LOCATION	
PKG NAME	G9WZMB
	3041
NEXT SPEC	

DRAFT	ENG	CHK	APP	ISSUE
	田川		小林	

G9WZMB PKG

Circuit Diagram

(F/W ROM, CG ROM
RAM Circuit)

136-443270-002-C

NEC

SHT 4/

EQUIP P6/P7

136-443270-002-C

REV	COMP	DESCRIPTION (SC)	APP
1	A	1985. 3.15	—
2	B	1985. 8.30	
3	C	1985. 11. 6	

DWG ABBR	
PKG LOCATION	
PKG NAME	G9WZMB
	(005)
NEXT SPEC	

DRAFT	ENG	CHK	APP	ISSUE
	平川			

G9WZMB PKG
Circuit Diagram
(Centro. Interface)

136-443270-002-C

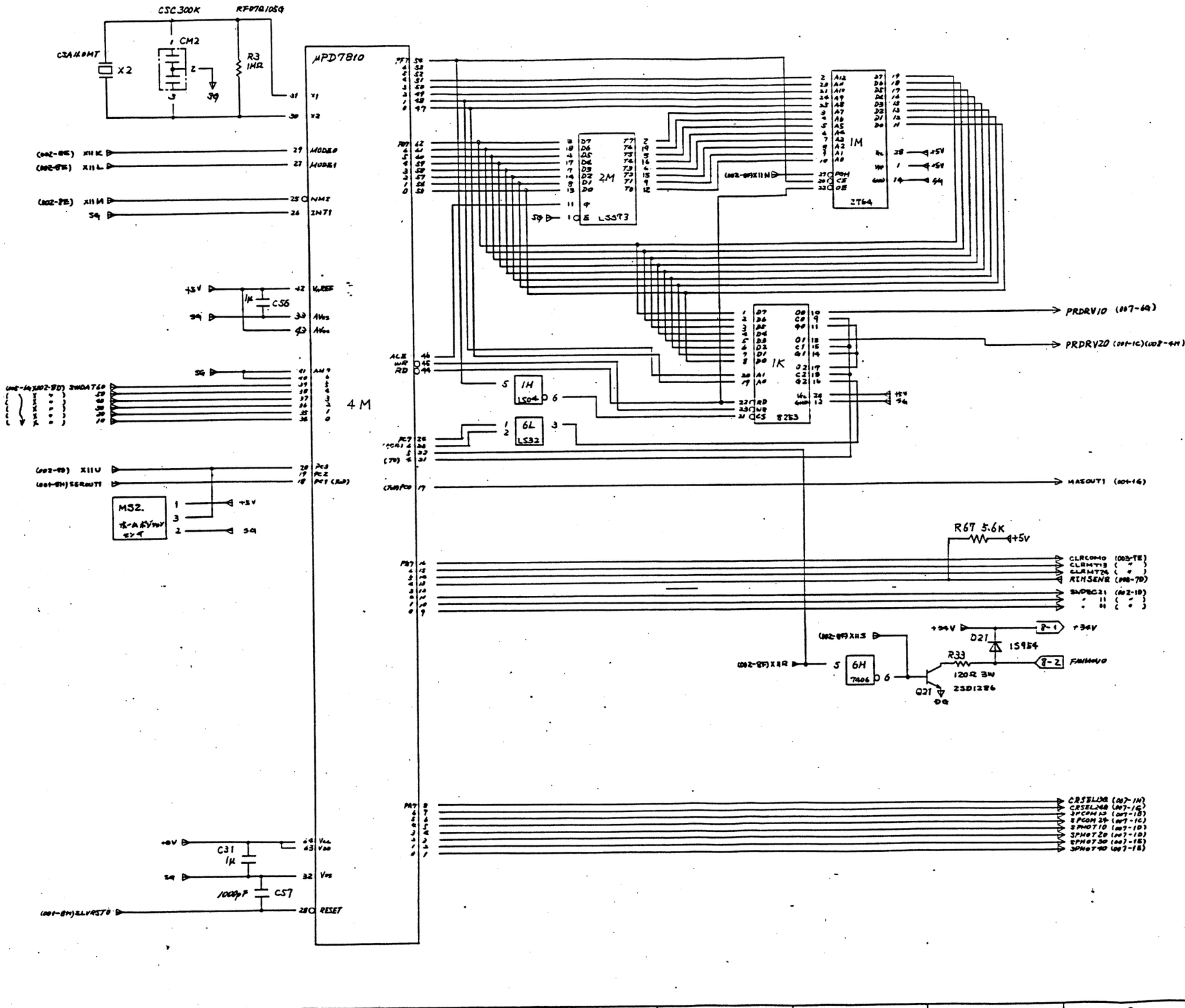
NEC

SHT 5/

EQUIP
P6/P7
CENTRO

136-443270-002-C

REV	COMP	DESCRIPTION (SC)	APP
1	A	1985. 3.15	
2	B	1985. 8.30	
3	C	1985. 11. 6	



DWG ABBR	
PKG LOCATION	
PKG NAME	G9WZMB
	(006)
NEXT SPEC	

DRAFT	ENG	CHK	APP	ISSUE

G9WZMB PKG
Circuit Diagram
(Slave MPU)

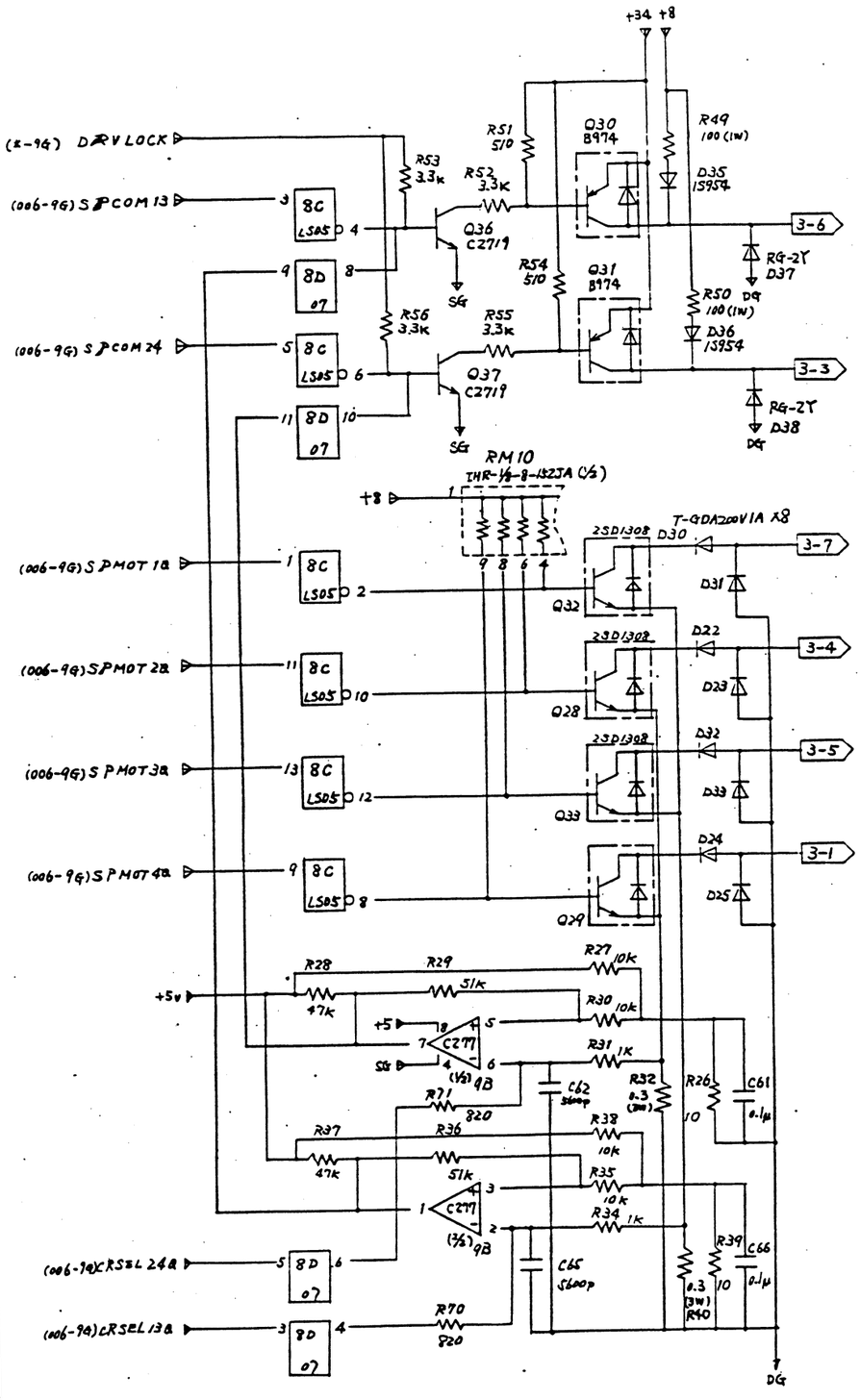
136-443270-002-C

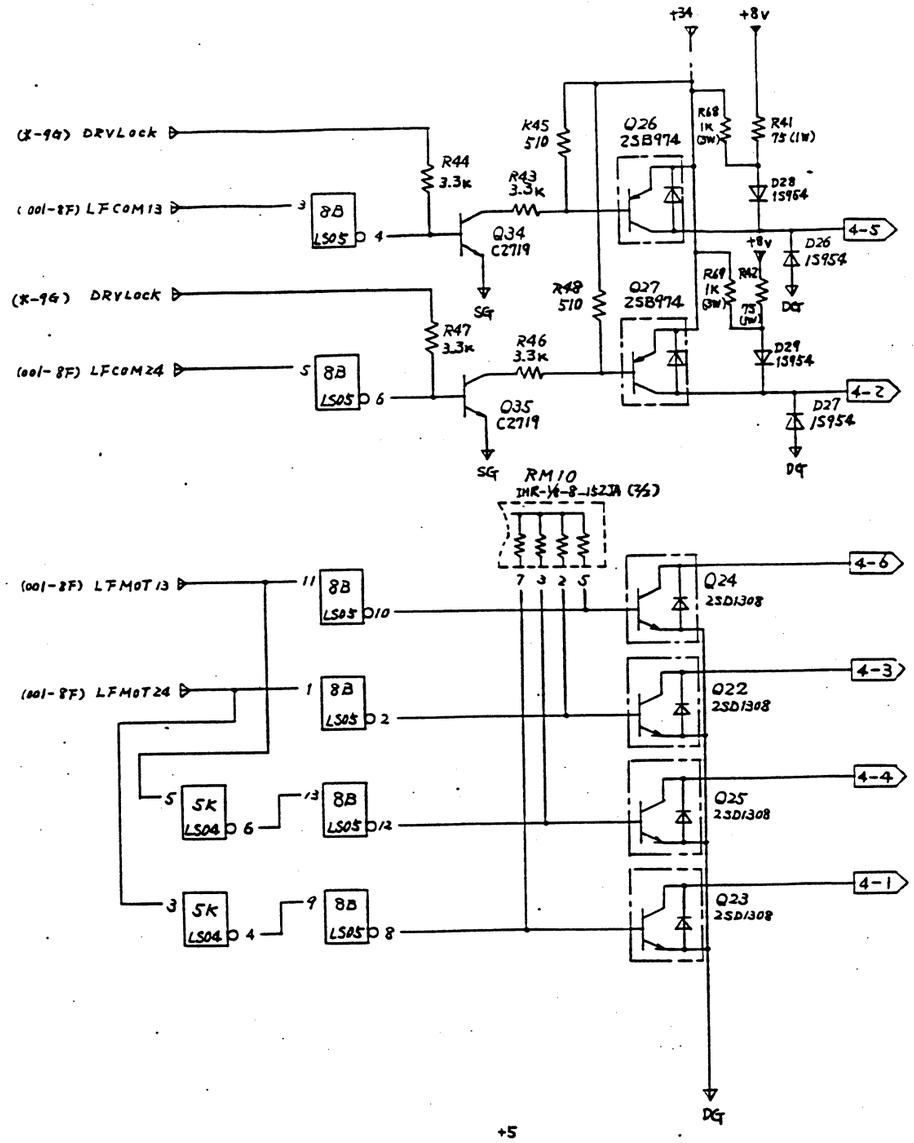
NEC SHT 6/

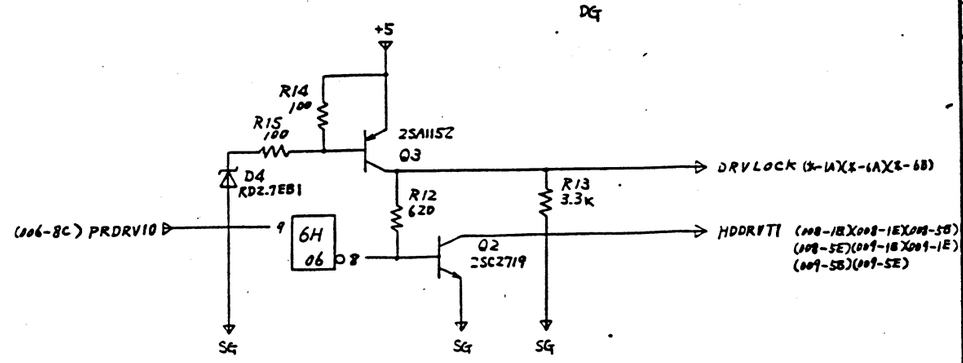
EQUIP
PC/PT

136-443270-002-C

REV	COMP	DESCRIPTION (SC)	APP
1	A	1985.3	
2	B	1985.8.30	
3	C	1985.11.6	







DWG ABBR	
PKG LOCATION	
PKG NAME	G9WZMB
	007
NEXT SPEC	

DRAFT	ENG	CHK	APP	ISSUE

G9WZMB PKG
Circuit Diagram
(SP., LF. Driver)

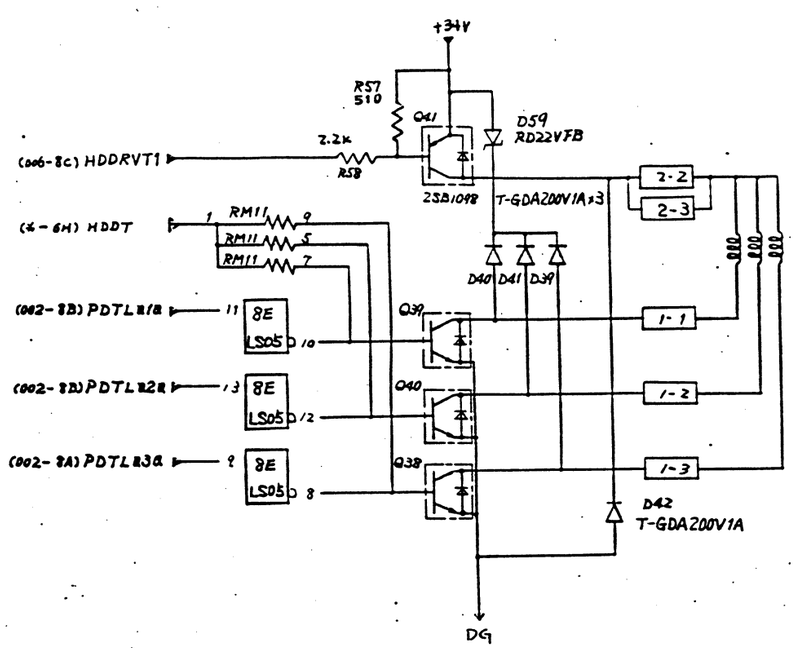
136-443270-002-C

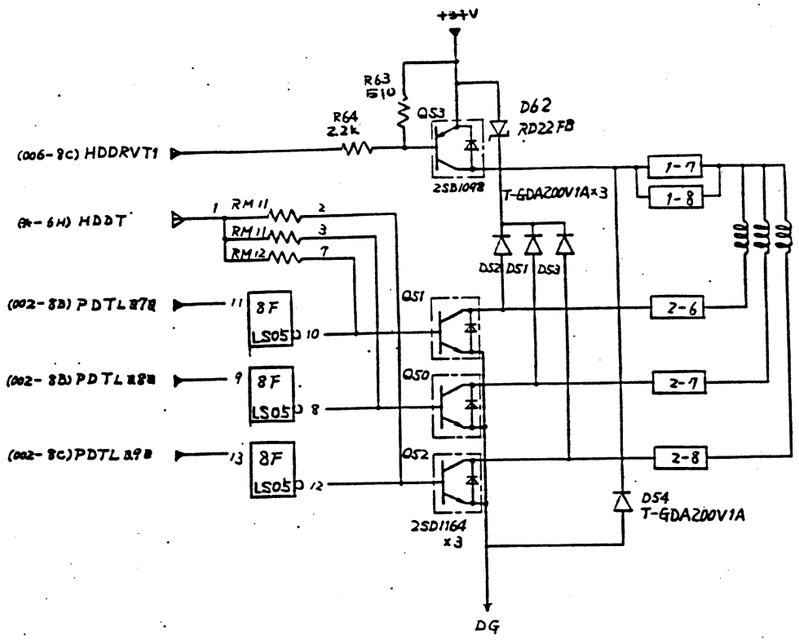
NEC SHT 7/

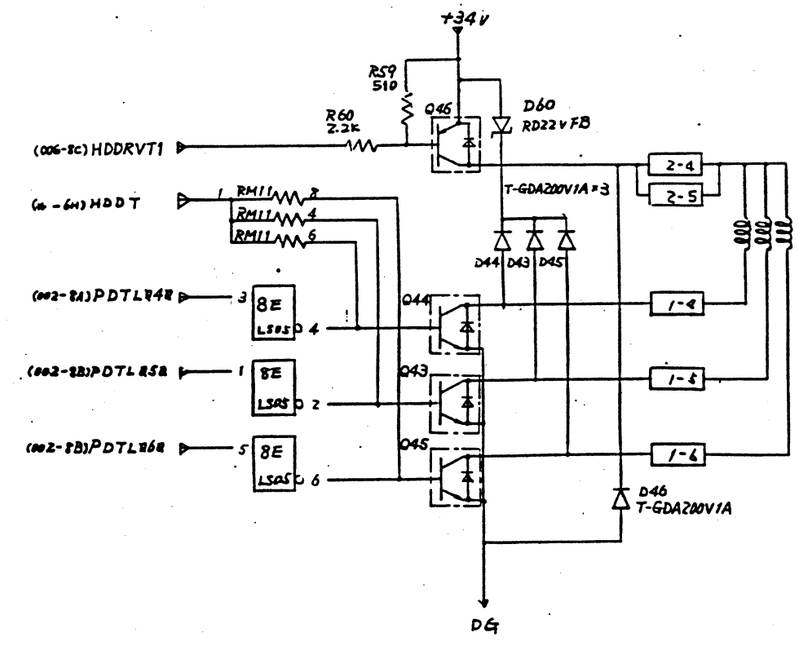
EQUIP

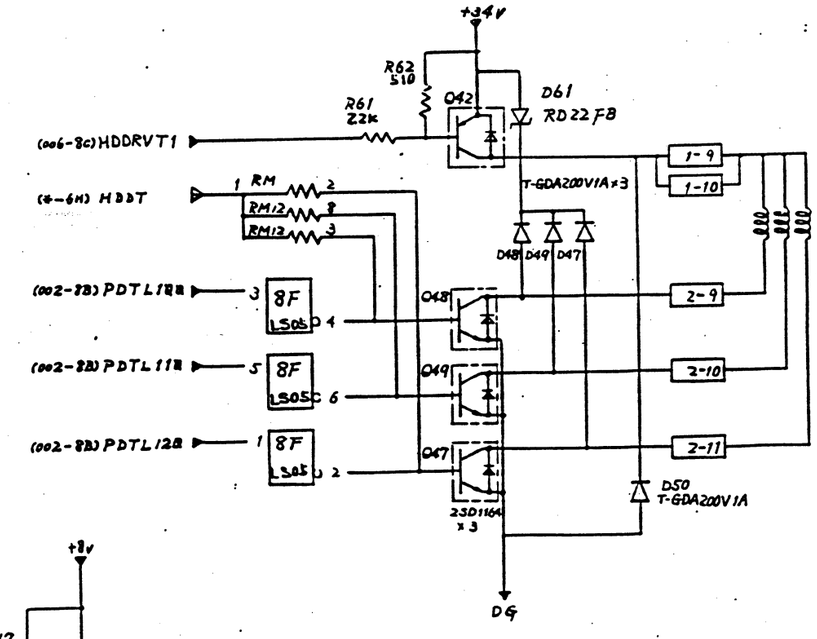
136-443270-002-C

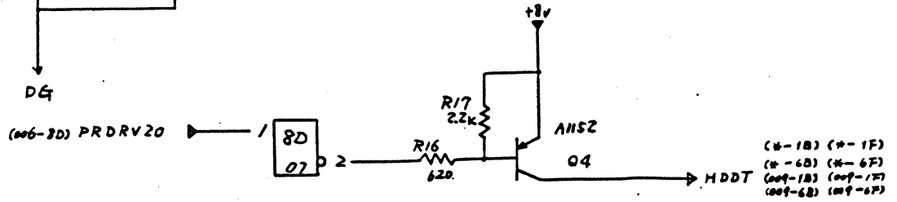
REV	COMP	DESCRIPTION (SC)	APP
1	A	1985.	
2	B	1985. 8. 30	
3	C	1985. 11. 6	

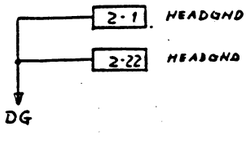












DWG ABBR				
PKG LOCATION				
PKG NAME	G9WZMB			
008				
NEXT SPEC				
DRAFT	ENG	CHK	APP	ISSUE
中村	上原		清水 0416946	

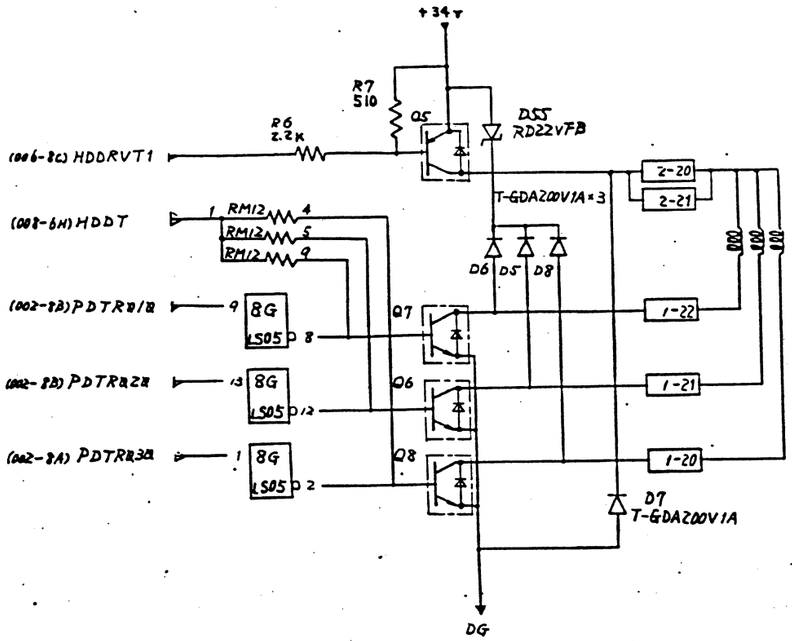
G9WZMB. PKG
Circuit Diagram
(Print Head Driver)

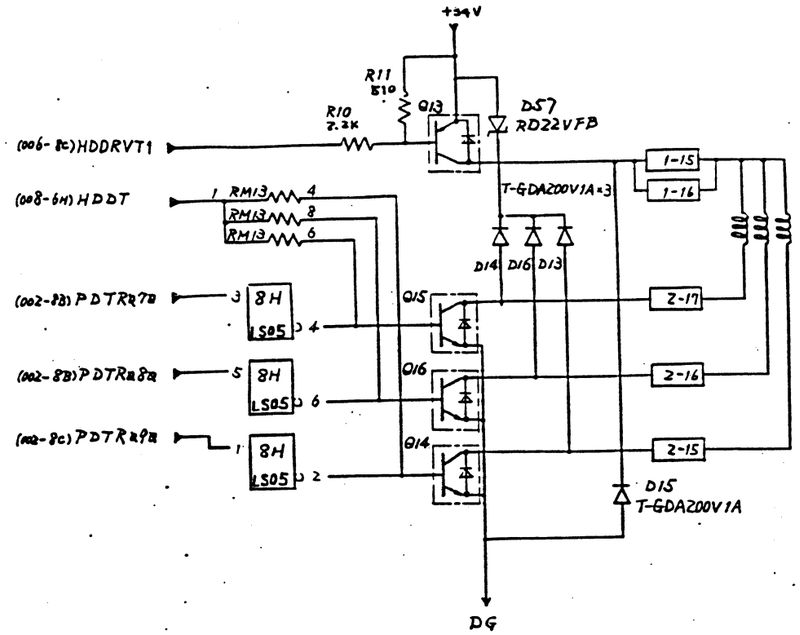
136-443270-002-C

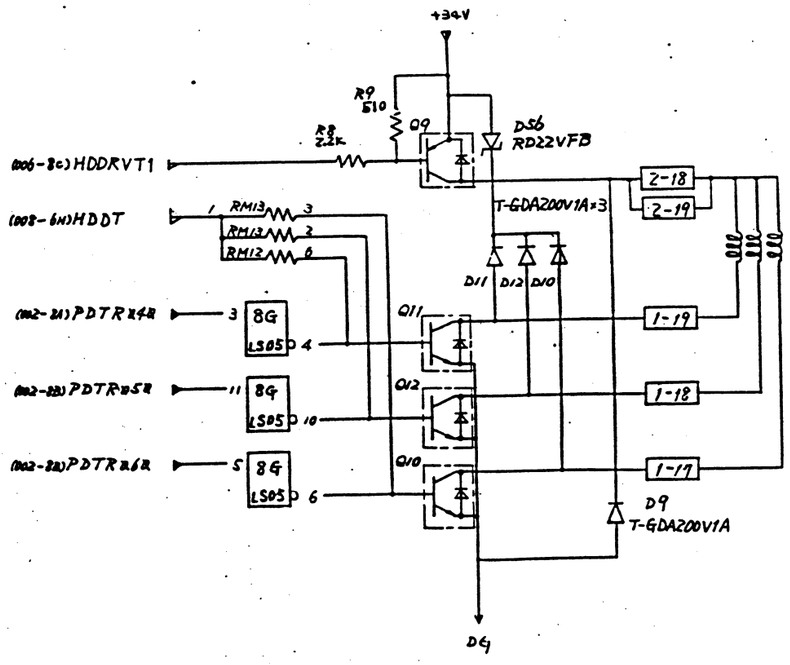
NEC SHT 8/

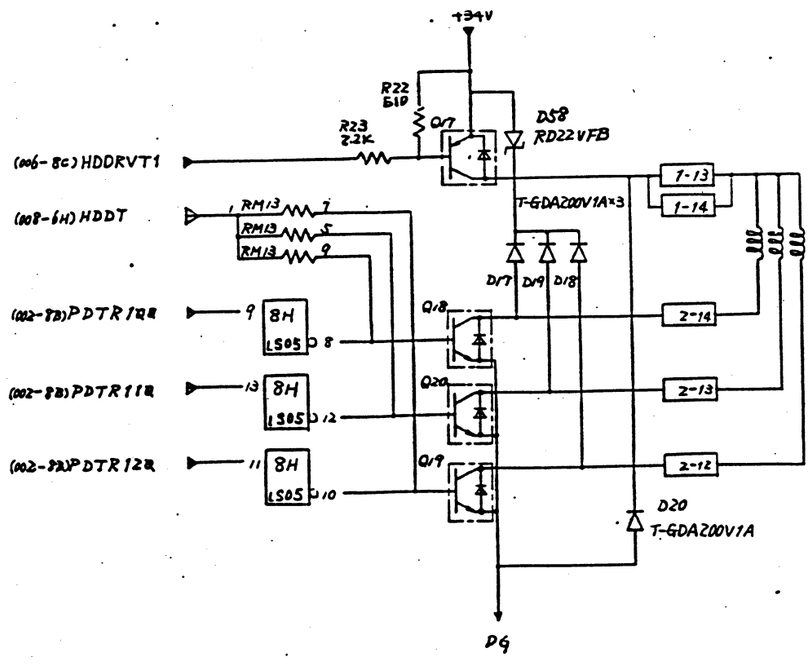
EQUIP

136-443270-002-C









REV	COMP	DESCRIPTION (SC)	APP
1	A	1985.	
2	B	1985. 8. 30	
3	C	1985. 11. 6	

DWG ABBR	
PKG LOCATION	
PKG NAME	G9WZMB
	009
NEXT SPEC	

DRAFT	ENG	CHK	APP	ISSUE
伊川	三井		三浦 04.09.16	

G9WZMB PKG
Circuit Diagram
(Print Head Driver)

136-443270-002-C

NEC SHT 9/9

EQUIP 30D

DB-413-2E

136-443270-002C

REV	COMP	DESCRIPTION (SC)	APP
1	A	1985. 3. 15	
2	B	1985. 8. 30 上津原	小西
3	C	1985. 11. 6 原紋変更 上津原	小西

DWG ABBR	
PKG LOCATION	
PKG NAME	G9W EMB
	(001)
NEXT SPEC	

DRAFT	ENG	CHK	APP	ISSUE

G9WZMB PKG

Circuit Diagram

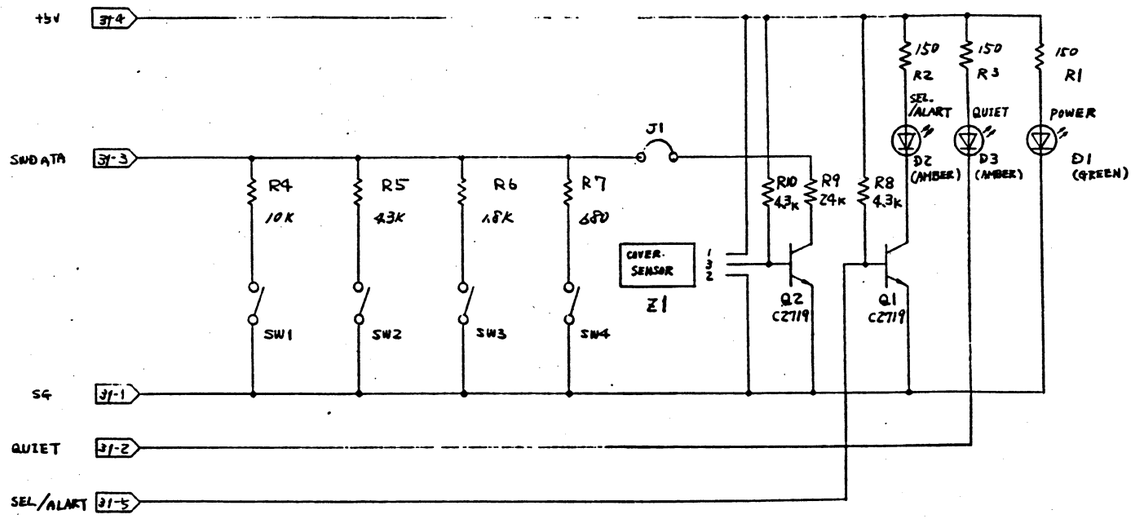
(Master MPU)

136-443270-002-C

NEC SHT 1/9

EQUIP P6/P7

E36-443271-B



REV	COMP	DESCRIPTION (SC)	APP
1	A	1985.3.16	
2	A	1985 5.17 R8 4.3K → 1K D4 1S954 → R9 4.3K R10, Q2 追加 上津原	設計 60.8.28 第一QA 西
3	B	1985. 11 ・D2, D3 発光色, 機能変更. ・カバーオープン検出回路変更. SC-507691	与原

DWG ABBR	
PKG LOCATION	
PKG NAME	G9WZN
NEXT SPEC	

DRAFT	ENG	CHK	APP	ISSUE
	052858		小西	設計 60.8.29 第一QA

~~G9WZN PKG~~

~~COPP~~

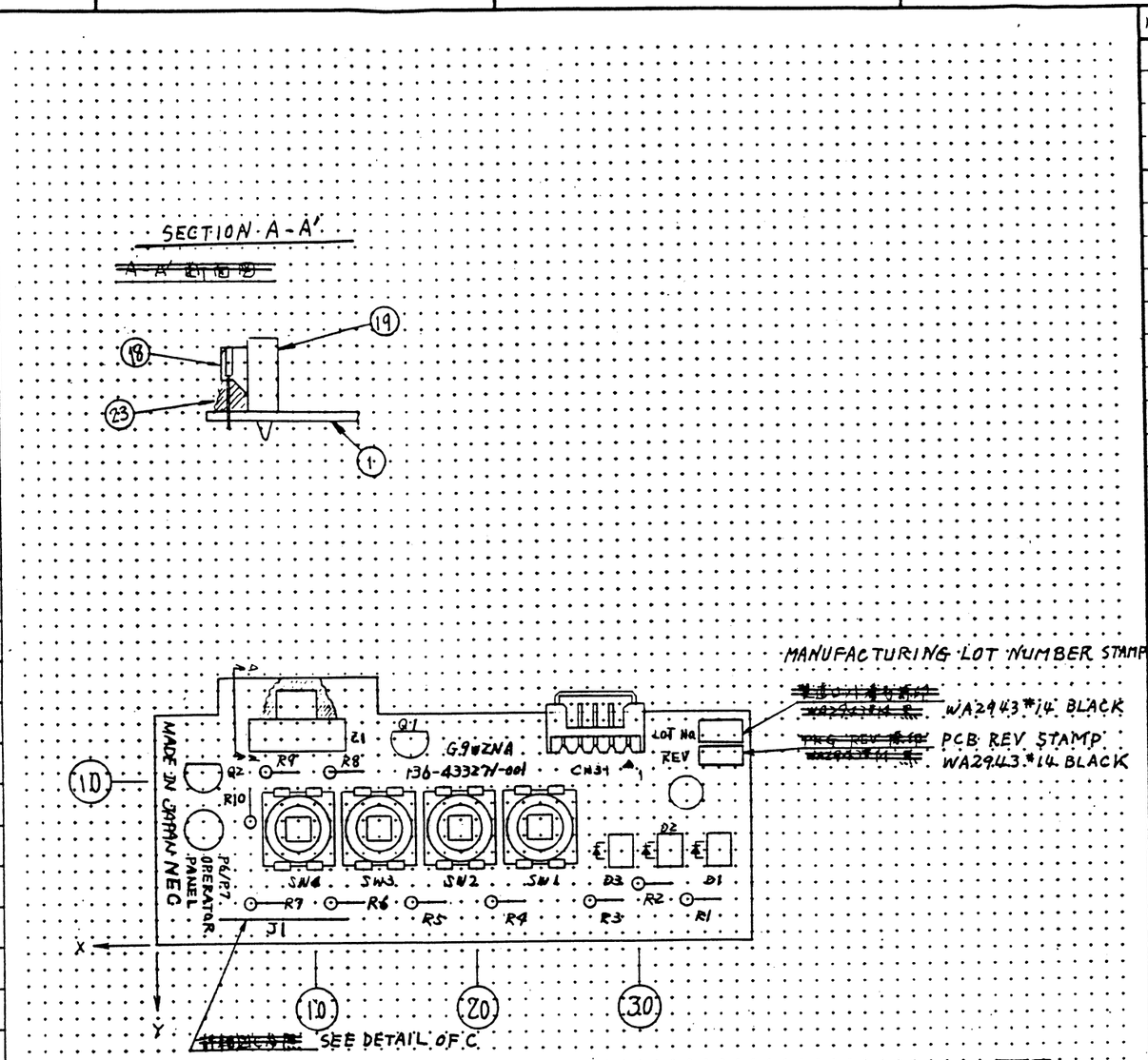
G9WZN PCB
(COPP)

E736-443271-~~A~~ B

NEC SHT 1/1

EQUIP
P6/P7

項番	記号	名称	A	指定	単位	数量
1		G9WZN PCB	P	E 136-453271-C	P	1
2						
3	D1	SG232D PHOTO DIODE	P	E 808-925000-001-A	P	1
4	D2. D3	SY432D PHOTO DIODE	P	E 808-926503-002-A	P	2
5						
6						
7						
8	Q1 Q2	2SC2719 TRANSISTOR	P	E 802-250030-002-0	P	2
9						
10	R1. R2. R3	T-REC25VJ151 RESISTOR	P	E 808-930200-044-A	P	3
11	R7	T-REC25VJ681 RESISTOR	P	E 808-930200-060-A	P	1
12	R6	T-REC25VJ182 RESISTOR	P	E 808-930200-076-A	P	1
13	R9	T-REC25VJ243 RESISTOR	P	E 808-930200-119-A	P	1
14	R5. R8, R10	T-REC25VJ432 RESISTOR	P	E 808-930200-085-A	P	3
15	R4	T-REC25VJ103 RESISTOR	P	E 808-930200-110-A	P	1
16						
17						
18	Z1	DN6837	P	E 808-927026-001-A	P	1
19		SENSOR HOLDER	P	E 136-753851-A	P	1
20	SW1, SW2, SW3, SW4	KHC10901 SWITCH	P	E 808-950351-005-A	P	4
21	CN31	4105-1004 HEADER	P	E 808-955209-004-A	P	1
22						
23		KE1187RTV RUBBER COMPOUND	P	E 808-835003-001-0	G	AR
24	J1	UL1430-AWG#22-9T	P	E 804-183001-249-0	M	0.04
25						



NOTES:

1. SYMBOL + REPRESENTS BASIC GRID 2.54 mm, AND SYMBOL • REPRESENTS SECOND GRID 0.635 mm.
2. LEAD WIRE LENGTH (SOLDERED PORTION) : 0.5~2.5 mm
3. MANUALLY MOUNTED PARTS
   - ⑳ SW1~SW4 (NO FLOAT FROM THE BOARD IS PERMITTED)
   - ③④ D1~D3 (FOR MOUNTING, SEE DETAILED DRAWING)

~~注: 本図は基本格子 2.54 mm~~
~~第2格子 0.635 mm~~
~~2. リード線長さ(半田面) 0.5~2.5 mm~~
~~3. 実付け部品~~
~~⑳ SW1~SW4 (基板よりの浮きが有りこと)~~
~~③④ D1~D3 (取付けは詳細図による)~~

項番	名称	指定	GRP

版数	ICOMP	記事 (SC)	承認	発行
1	A	1984. 3. 20	—	—
2	A	1985. 8. 28 SC-503915 上津尔 生技原田	小曲	発行 60.9.30 第-0A
3	B	1985. 11. 13 SC-507278 上津尔 生技 津国	小曲	

主任査閲 中村

親仕様

第三角法	尺度 1/0.635	特に指定なきは社内普通公差とす。

技術担当	技術承認	設計製図	査閲	承認	発行
84.2.28					発行 60.8.-0 第-0A

名称: G9WZN「A」PCB ASSEMBLY DRAWING ~~組立図~~

図番: E 136-433271-001-B

NEC 日本電気株式会社 SHT 1/1

装置名: P6/P7

136-433271-001-B

DB-403-510
US A3 (420×594)

E136-453271-C

項番	記号	名称	A	指定	単位	数量

SPECIFICATIONS

UNIT: mm

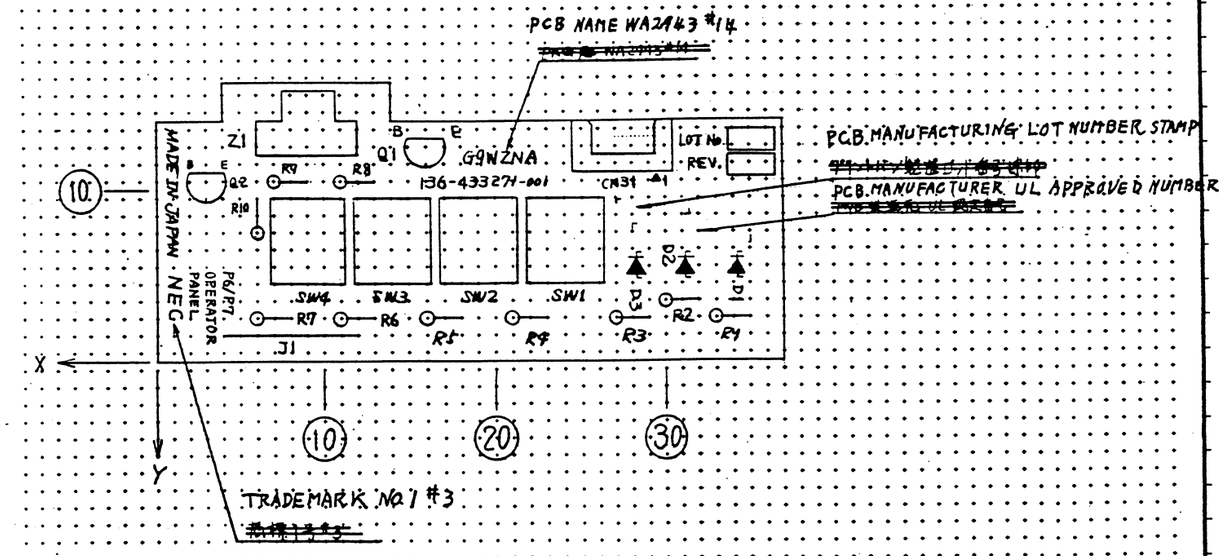
PCB TYPE	~~DOUBLE SIDED BOARD~~		
REFERENCE DRAWING			
DRAWING NAME	NUMBER	COMP	REV
EXTERNAL VIEW	E136-400599-611	A	1
ASSEMBLY	E136-433271-001	B	3
MARKING	THIS DRAWING		
PATTERN (CO-SIDE)[1]	———		
PATTERN (SO-SIDE)[2]	E136-453271 (2/3)	C	3
MASKING (CO-SIDE)	———		
MASKING (SO-SIDE)	E136-453271 (3/3)	C	3
MASKING AREA	———		
CONSTRUCTION[3]			
BASE MATERIAL	FR2 $1.6t \pm \frac{0.2}{0.15}$		
CONDUCTOR THICKNESS	35μ (RC-5600)		
~~THROUGH HOLE PLATING~~	~~COPPER PLATING (15μ MIN.)~~		
~~PATTERN PLATING~~	~~COPPER PLATING (15μ MIN.)~~		
~~EDGE BOARD CONTACTS PLATING~~	~~NICKEL GROUND PLATING (2μ MIN.)~~ ~~GOLD FINAL PLATING (1.5μ MIN.)~~		
SOLDER RESIST	~~DOUBLE SIDED PRINTING~~, GREEN(10-20μ)		
MARKING	SINGLE-SIDED PRINTING, BLACK		
DESIGN STANDARD			
BASIC GRID SPACING[4]	2.54		
SECONDARY GRID SPACING	0.635		

HOLES DIAMETER	SYMBOL	PLATED-THROUGH	LAND	THROUGH
	○	$\phi 1.0^{\pm 0.1}$	$\phi 2.0^{\pm 0.1}$	
	⊗	$\phi 1.2^{\pm 0.1}$	$\phi 3.0^{\pm 0.1}$	
	⊕	$\phi 1.0^{\pm 0.1}$	$\phi 2.8^{\pm 0.1}$	

CONDUCTOR WIDTH	STANDARD: 0.25 ± 0.1 OTHER: SEE GRID DIMENSION
MIN.CONDUCTOR SPACING	0.3
CHARACTER FONT	ETCHING CHARACTER: WA-2943 ~~#15~~ #15 MARKING CHARACTER: WA-2943 ~~#15~~ #15 TRADEMARK: TRADEMARK NO.1 #3

MASKING DIAMETER	LAND	MASKING (CO-SIDE)	MASKING (SO-SIDE)
	$\phi 2.0$		$\phi 2.6$
	$\phi 2.6$		$\phi 3.2$
	$\phi 3.0$		$\phi 3.4$

SCALE	1/0.635
DRAWING METHOD	PERSPECTIVE FROM CO-SIDE
OTHER	REFER TO ES-14-113



NOTES:

1. THIS PART IS ONE OF 10 BLOCKS ON THE DIVIDED MAIN BOARD.
2. MARKING MUST BE IN BLACK.
3. CHARACTER SIZE MUST BE WA-2943 #15 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

~~ほし 10枚取り割り基板~~
~~2 マーキングはすべて黒とする。~~
~~3 指定以外の文字サイズは WA-2943 #15とする~~

NOTES 1. "CO-SIDE" MEANS COMPONENT SIDE.
2. "SO-SIDE" MEANS SOLDER SIDE.
3. APPLY FLUX BEFORE PERFORMING TREATMENT AS SPECIFIED.
4. HOLES MUST BE POSITIONED ON BASIC GRIDS UNLESS OTHERWISE SPCIFIED.

項番	名称	指定	GRP

版数	COMP	記事 (SC)	承認	発行
·	A	1985.3.20	——	——
二	B	1985.7.17 SC-504085 上津原 生技課回	小西	発行 60.9.20 第-0A
3	C	1985.11.13 SC-507278 上津原 生技津国	小西	

生技意図: 中村 3/9

親仕様

第三角法	尺度 1/0.635	特に指定なきは社内普通公差とす。

技術担当	技術承認	設計製図	査閲	承認	発行
伊川 F-4318	神	F-			60.11 第-0A

名称 G9WZN PCB MARKING DRAWING
~~G9WZN プリントバン マーキング図~~

図番 E136-453271-C

NEC 日本電気株式会社 SHT 1/3

装置名 P1/P7

DB-403-511
US A3 (420×594)

E136-453271-C

項番	記号	名称	指定	位置	数量

SPECIFICATIONS

UNIT:mm

PCB TYPE	~~DOUBLE-SIDED BOARD~~		
REFERENCE DRAWING			
DRAWING NAME	NUMBER	COMP	REV
EXTERNAL VIEW	E136-400599-611	A	1
ASSEMBLY	E136-433271-001	B	3
MARKING	E136-453271 (1/3)	C	3
PATTERN (CO-SIDE)[1]	——		
PATTERN (SO-SIDE)[2]	THIS DRAWING		
MASKING (CO-SIDE)	——		
MASKING (SO-SIDE)	E136-453271 (3/3)	C	3
MASKING AREA			

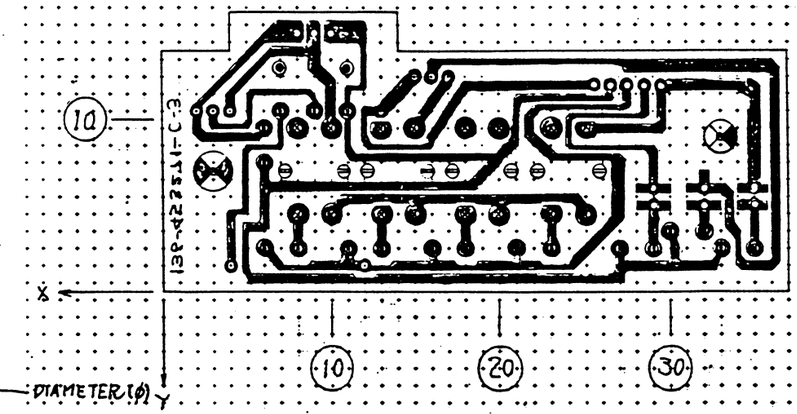
CONSTRUCTION[3]	
BASE MATERIAL	FR2 , 1.6t $\pm^{0.2}_{0.15}$
CONDUCTOR THICKNESS	35μ
~~THROUGH HOLE PLATING~~	~~COPPER PLATING (15μ MIN.)~~
~~PATTERN PLATING~~	~~COPPER PLATING (13μ MIN.)~~
~~EDGE BOARD CONTACTS PLATING~~	~~NICKEL GROUND PLATING (2μ MIN.) GOLD FLASH PLATING (0.3μ MIN.)~~
SOLDER RESIST	~~DOUBLE-SIDED PRINTING~~, GREEN(10-20μ)
MARKING	SINGLE-SIDED PRINTING, BLACK

DESIGN STANDARD				
BASIC GRID SPACING[4]	2.54			
SECONDARY GRID SPACING	0.635			
HOLES DIAMETER	SYMBOL	PLATED-THROUGH	LAND	THROUGH
	○	$\phi 1.0^{\pm 0.1}$	$\phi 2.0^{\pm 0.1}$	
	⊗	$\phi 1.2^{\pm 0.1}$	$\phi 3.0^{\pm 0.1}$	
	◉	$\phi 1.0^{\pm 0.1}$	$\phi 2.8^{\pm 0.1}$	
CONDUCTOR WIDTH	STANDARD: 0.25 $\pm$ 0.1 OTHER: SEE GRID DIMENSION			
MIN.CONDUCTOR SPACING	0.3			
CHARACTER FONT	ETCHING CHARACTER:WA-2943 #14 MARKING CHARACTER:WA-2943 #14 TRADEMARK: TRADEMARK NO.1 #3			

MASKING DIAMETER	LAND	MASKING (CO-SIDE)	MASKING (SO-SIDE)
	$\phi 2.0$		$\phi 2.6$
	$\phi 2.8$		$\phi 3.2$
	$\phi 3.0$		$\phi 3.4$

SCALE	1/0.635
DRAWING METHOD	PERSPECTIVE FROM CO-SIDE
OTHER	REFER TO ES-14-113

NOTES 1. "CO-SIDE" MEANS COMPONENT SIDE.
2. "SO-SIDE" MEANS SOLDER SIDE.
3. APPLY FLUX BEFORE PERFORMING TREATMENT AS SPECIFIED.
4. HOLES MUST BE POSITIONED ON BASIC GRIDS UNLESS OTHERWISE SPCIFIED.



SYMBOL

	DIAMETER(φ)
~~●~~	~~1.36~~
⊘	1.0
⊗	1.2
⊖	1.8
◉	2.0
⊗	5.0
⊖	6.0

~~※1. PCB名称打刻参照~~

NOTE. THIS PART IS ONE OF 10 BLOCKS ON THE DIVIDED MAIN BOARD.

版数	COMP	記事 (SC)	承認	発行
1	A	1985.3.20	—	—
2	B	1985.7.17		
3	C	1985.11.13 中村		

生技審閲 中村 3/8

親仕様

第三角法 | 尺度 1/0.635 | 特に指定なきは社内普通公差とす。

技術担当	技術承認	設計製図	査閲	承認	発行
4820938 中川 F-4318	神子沼				

名称 G9WZN PCB PATTERN DRAWING
~~G9WZN プリントパターン~~
~~ベース図~~

図番 E136-453271-C

NEC 日本電気株式会社 SHT 2/3

装置名 P6/P7

項番	名称	指定	GRP

DB-403-511
JIS A2 (420×594)

本, 巻, 冊, 缶, 枚, 式, 通, ダース, メートル, フィート, グラム, リットル, その他

E136-453271-C

項番	記号	名称	A	指定	単位	数量

SPECIFICATIONS

UNIT: mm

PCB TYPE	DOUBLE-SIDED BOARD		
REFERENCE DRAWING			
DRAWING NAME	NUMBER	COMP	REV
EXTERNAL VIEW	E136-400599-611	A	1
ASSEMBLY	E136-433271-001	B	3
MARKING	E136-453271 (1/3)	C	3
PATTERN (CO-SIDE)[1]	———		
PATTERN (SO-SIDE)[2]	E136-453271 (2/3)	C	3
MASKING (CO-SIDE)	———		
MASKING (SO-SIDE)	THIS DRAWING		
MASKING AREA	———		

CONSTRUCTION[3]	
BASE MATERIAL	FR2, 1.6t $\pm^{0.2}_{0.15}$
CONDUCTOR THICKNESS	35μ
~~THROUGH HOLE PLATING~~	~~COPPER PLATING (15μ MIN.)~~
~~PATTERN PLATING~~	~~COPPER PLATING (15μ MIN.)~~
~~EDGE BOARD CONTACTS PLATING~~	~~NICKEL GROUND PLATING (2μ MIN.) COLD FINAL PLATING (1.5μ MIN.)~~
SOLDER RESIST	~~DOUBLE SIDED PRINTING~~, GREEN(10-20μ)
MARKING	SINGLE-SIDED PRINTING, BLACK

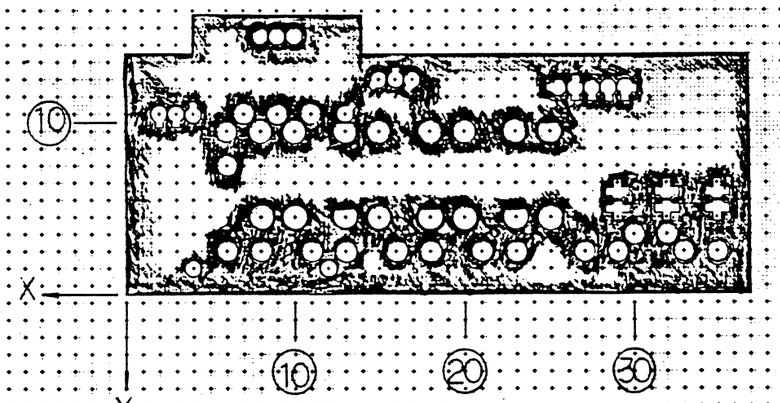
DESIGN STANDARD				
BASIC GRID SPACING[4]	2.54			
SECONDARY GRID SPACING	0.635			
HOLES DIAMETER	SYMBOL	PLATED-THROUGH	LAND	THROUGH
	○	$\phi 1.0^{\pm 0.1}$	$\phi 2.0^{\pm 0.1}$	
	⊗	$\phi 1.2^{\pm 0.1}$	$\phi 3.0^{\pm 0.1}$	
	①	$\phi 1.0^{\pm 0.1}$	$\phi 2.8^{\pm 0.1}$	
CONDUCTOR WIDTH	STANDARD: 0.25 ± 0.1 OTHER: SEE GRID DIMENSION			
MIN.CONDUCTOR SPACING	0.3			
CHARACTER FONT	ETCHING CHARACTER:WA-2943 #14 MARKING CHARACTER:WA-2943 #14 TRADEMARK: TRADEMARK NO.1 #3			

MASKING DIAMETER	LAND	MASKING (CO-SIDE)	MASKING (SO-SIDE)
	$\phi 2.0$		
	$\phi 1.6$	$\phi 1.6$	$\phi 2.6$
	$\phi 2.8$		$\phi 3.2$
	$\phi 3.0$		$\phi 3.4$

SCALE	1/0.635
DRAWING METHOD	PERSPECTIVE FROM CO-SIDE
OTHER	REFER TO ES-14-113

NOTES 1. "CO-SIDE" MEANS COMPONENT SIDE.
2. "SO-SIDE" MEANS SOLDER SIDE.
3. APPLY FLUX BEFORE PERFORMING TREATMENT AS SPECIFIED.
4. HOLES MUST BE POSITIONED ON BASIC GRIDS UNLESS OTHERWISE SPCIFIED.

項番	名称	指定	GRP



~~NOTE~~ NOTE. THIS PART IS ONE OF 10 BLOCKS ON THE DIVIDED MAIN BOARD.

版数	COMP	記事 (SC)	承認	発行
1	A	1985·3·27	——	——
2	B	1985. 7. 17		
3	C	1985. 11. 13 牧沖		

生技意図
中村 3/28

親仕様	
第三角法	尺度 1/0.635
特に指定なきは社内普通公差とす。	

技術担当	技術承認	設計制図	意図	承認	発行
中村					
F-4318		F-			

名称 G9WZN PCB MASKING DRAWING
~~G9WZN プリントパターン~~
~~マスキング図~~

図番 E136-453271-C

NEC 日本電気株式会社 SHT 3/3

装置名 P6/P7

DB-403-511
US A2 (420×594)

E136-443272-D

REV	COMP	DESCRIPTION (SC)	APP
1	A	1985.03.16	——
2	B	1985·05·30 NECO-100412-02 塩田	新垣
3	C	1985.08.28 塩田	新垣
4	C	1985.09.10 NECO-100412-33 塩田	新垣
5	D	1985.11.19 SC-211397 塩田 (NECO-100412-46)	新垣
6	D	1985.11.20	

CN21 F1 L1 L2 RC1 SW1 C1 220pF C2 220pF C3 330pF C4 330p C5 0.1μ C6 0.22μ CH1 S1

R1 51K 2W R3 51K 2W R5 3.3K 2W R2 620K R4 620K

D1 400V 4700p C10 9K 9K 9K R9 R19 R20 R7 15 3W

HIC 1

2200p 1K 3.9K 100K 47K 270p 22000p 470 C7 400V 180μ

220 18K 47 10000p 3.1K 4.7K 680

D3 D4 D5 S2 C8 220μ 16V 0.1μ 16V C9 220μ 16V R10 330

RM1 2.7K 1.3K 1.3K 1.3K 7.2K 2.2K 7.2K C8 220μ 16V R8 0.68 3W

TP1 D2 L3 4.7μH L4 4.7μH PS1 PS2

T1

R13 10 C14 1000p RC3 C17 6800μ 40V R16 2K 2W R17 2K 2W R18 2K 2W F3

C11 1000p R12 10 RC2 C13 4700μ 16V F2 C12 50V 0.47μ R11 1K C16 16V 220μ

CN22 +34 DG +8 +5 SG

PS2 PS1 R15 3.9K 1W 390 1K 13K RD3.9EB RD6.8EB VR1 25C249 33 3K

HIC 2

DWG ABBR	
PKG LOCATION	
PKG NAME	G9WZS
NEXT SPEC	

DRAFT	ENG	CHK	APP	ISSUE
(おた	D4000 5 佐藤		函	新村 60.10.30 第-0A

G9WZS PCB SCHEMATIC DIAGRAM

E136-443272-D

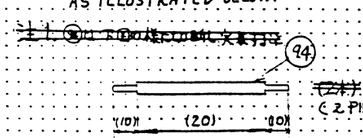
NEC SHT 1/1

EQUIP pinwriter P6, P7

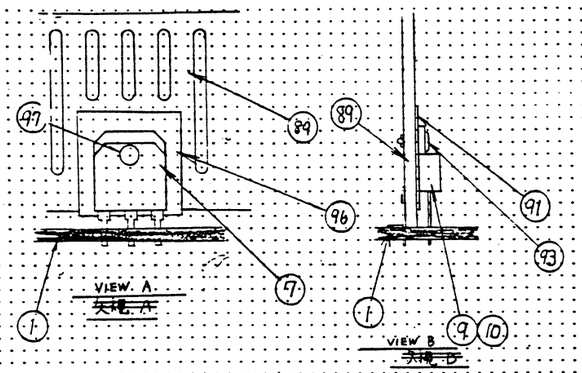
D8-413-2E

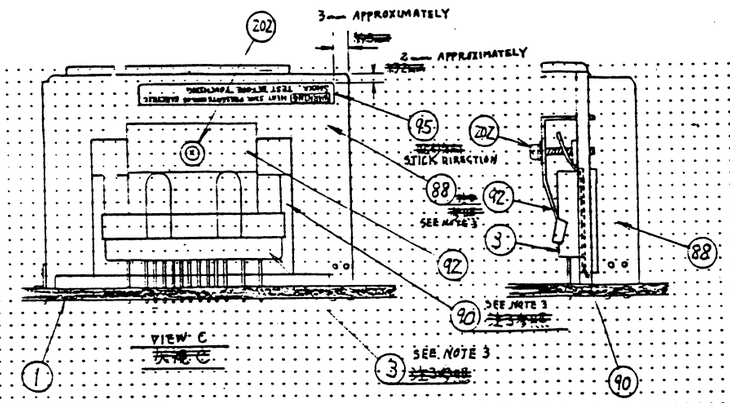
E136-433272-B

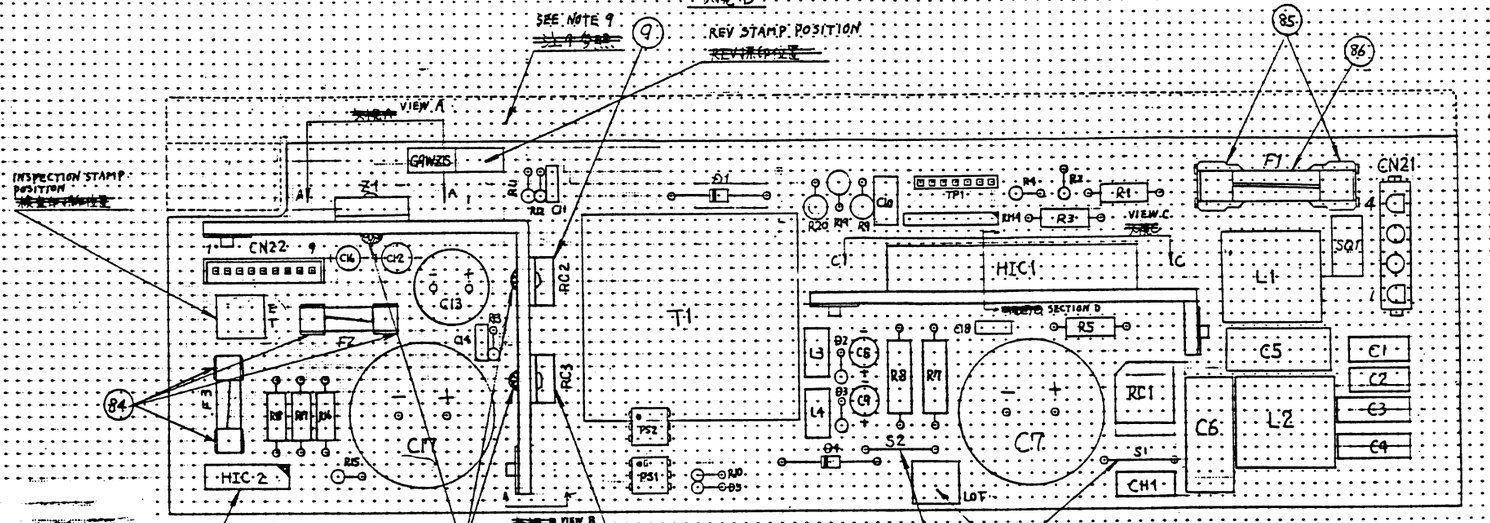
NOTE 1. MOUNT (94) BY CUTTING IT AS ILLUSTRATED BELOW.



~~S1, S2 ピン ﾋﾟｯﾁ 15.24 (6P)~~
DIMENSION BETWEEN S1 AND S2
15.24 mm (6P)

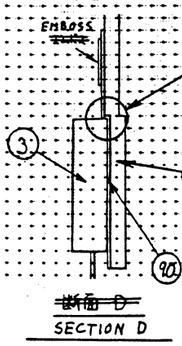






NOTE 3: SECTION D OF HEATSINK ASSEMBLY IN VIEW C AND VERTICAL POSITIONING OF (3) ARE SHOWN BELOW.

~~注3. 矢視C図ヒートシンクA...の断面 DE 下図に示す。~~
~~次に(3)ねじ(88)の位置を下図に示す。~~



~~断面 D~~
SECTION D

~~注4. (21), (22), (25), (39), (40), (43), (45), (47)~~
~~(3) は フロロセン浸漬洗浄禁止部品とする~~

~~注5. REV, LOT, 検査印の捺印色は黒色とする。~~

~~注6. 半田面のパターンマスキング逃げ部は半田で覆われていること。~~

~~注7. 締付けトルクは 7 kg-cm とする。~~

~~注8. (5), (9), (10) を (73) で固定後 (88) 部にアルテコを塗布すること。~~

~~注9. 点線部は 洗浄後 切離すること。~~

~~注10. ネジ(73), (88), 放熱ﾌﾟﾚｰﾄ(92), (93) は 浮かない様に実装すること。~~

NOTE 4. PARTS (20), (23), (25), (39), (40), (43), (45), (47) AND (3) MUST NOT BE DIPPED IN OR WASHED WITH 1,1,1-TRICHLOROETHANE.

NOTE 5. STAMPING OF REV., LOT AND INSPECTION STAMP MUST BE MADE IN BLACK.

NOTE 6. PATTERN MASKING RELIEF PORTION ON SOLDERED SURFACE MUST BE COVERED WITH SOLDER.

NOTE 7. TIGHTENING TORQUE IS 7 Kg-cm.

NOTE 8. APPLY ALTECO ON THE HATCHED PORTIONS AFTER FIXING (5), (9) AND (10) WITH (73) AND (73).

NOTE 9. AFTER WASHING, CUT THE DOT LINE PORTION.

NOTE 10. MOUNT CONNECTOR (73) AND (88) AND HEAT RADIATION PLATE (88) AND (87) SO THAT THEY DO NOT FLOAT.

PARTS HEIGHT / LEAD WIRE LENGTH

部品高さ	リード線長さ
68 mm MAX	2.5 mm MAX

機番	COMP	記事 (SC)	承認
1	A	1985.05.11	—
2	A	1985.08.30 SC-50282	新垣
3	A	1985.09.13 SC-50524-2	新垣
4	B	1985.11.20 SC-50732	

堀田 堀田

原図 1/2

現仕様

設計製図	作成担当	直	知	承	認	発	行
堀田	堀田	佐藤	新垣				

GAWZS
PCB
ASSEMBLY

E136-433272-B

NEC

1/2

日本電気株式会社

E136-433272-B

項番	記号	名称	A	指定	単位	数量
1		G9WZS PCB	P	136-453272-E	P	1
3	HIC1	HIC STK7408	P	802-120230-002-A	P	1
4	HIC2	H-03PW	P	808-912318-003-A	P	1
5	Z1	SI-3052V	P	802-120250-001-A	P	1
6	PS1,2	H11AV2	P	808-927032-001-A	P	2
3	RC1	S2VB40	P	802-220055-013-01	P	1
9	RC2	CTL-12S	P	802-220061-001-A	P	1
10	RC3	CTU-24S	P	808-925011-001-A	P	1
11	D1,4	FRD1000V0.8A	P	802-210036-001-A	P	2
12	D2,3	T-FRDA200V1.0A	P	802-210021-102-A	P	2
14	D5	1S953-TS	P	802-210018-002-01	P	1
21	L1	L6029B	P	808-940602-004-B	P	1
22	L2	UF-2327S-502Y1R0	P	802-530123-001-A	P	1
23	L3,4	T-ELO606RA-4R7K	P	802-530129-001-A	P	2
25	T1	T3237B	P	808-940323-007-B	P	1
29	CH1	8D-11	P	808-927003-005-A	P	1
30	SQ1	VR470D14Φ	P	808-926201-001-A	P	1
35	C1,2	CK45-E2GA222MYASE	P	808-935562-023-A	P	2
36	C3,4	CK45-E2GA332MYASE	P	808-935562-022-A	P	2
37	C5	ECQ E2A104MW	P	808-935163-021-A	P	1
38	C6	ECQ-E2A224MW	P	808-935163-020-A	P	1
39	C7	CEM400V180uF	P	808-935394-081-A	P	1
40	C8,9,12	T-CEM 16V 220uF	P	802-410067-032-A	P	3
41	C10	DE7100FZ472PVA1	P	808-935562-010-A	P	1
42	C11,14	T-CK45B102K500V	P	808-935504-103-A	P	2
43	C13	CEM-K16V4700uF	P	808-935394-242-A	P	1
45	C16	T-CE50VR47uF	P	808-935300-023-A	P	1
47	C17	CEM40V6800uF	P	808-935394-281-A	P	1
48	C18	T-BC45BC104Z16V	P	808-935300-001-A		

項番	記号	名称	A	指定	単位	数量
52	RM1	NWR2-065	P	808-930394-065-A	P	1
55	R1,3	ERG2SJ513P	P	802-310051-303-A	P	2
56	R2,4	T-REC25VJ624	P	808-930200-153-A	P	2
57	R5	ERG3SJ332P	P	802-310051-312-A	P	1
60	R7	ERG3SJ150P	P	802-310051-543-A	P	1
61	R8	ERX3SJ R68P	P	802-310051-547-A	P	1
67	R10	T-REC25VJ331	P	808-930200-052-A	P	1
68	R11	T-REC25VJ102	P	808-930200-070-A	P	1
69	R12,13	T-REC25VJ100	P	808-930200-010-A	P	2
72	R15	T-ERG1SJ392B	P	802-310053-315-A	P	1
73	R16,17,18	ERG2SJ202P	P	802-310051-301-A	P	3
74	R9,R19,R20	ERG3SJ913U	P	802-310051-604-A	P	3
79	CN21	350430-1	P	808-955140-365-A	P	1
80	CN22	PEH-109	P	802-710200-104-0	P	1
81	TP1	PHD-007	P	808-955244-007-A	P	1
84		H0011-1 FUSE CLIP	P	808-802166-001-A	P	4
85		F-208 FUSE CLIP	P	808-960304-003-A	P	2
86		FF250V2A	P	808-960321-001-A	P	1
87		FF 125V 4A	P	808-960321-012-A	P	2
88		HEAT SINK PLATE AD ASSEMBLY	A	136-782296-001-A	P	1
89		HEAT SINK PLATE A2 ASSEMBLY	A	136-782297-001-A	P	1
90		TRANSISTOR SPACER BC	P	136-782343-A	P	1
91		TRANSISTOR SPACER B	P	136-747702-002-C	P	1
92		PRESSURE PLATE C	P	136-782342-B	P	1
93		NR-354 NYLON RIVET	P	808-814062-354-A	P	2
94		UL1430AWG22-105-1)-9	P	808-847047-109-A	M	0.16
95		HEAT SINK LABEL B	P	136-703852-A	P	1
96		SPACER AA	P	136-781732-003-A	P	1
97		NR-385	P	808-814062-385-A	P	1

項番	記号	名称	A	指定	単位	数量
202		PL-CPIMSX3X18N58F	P	80*-300003-018-01	P	1

項番	記号	名称	A	指定	単位	数量

REV	COMP	記事 (SC)	承認
1	A	1985.05.11	
2	A	1985.08.30 SC-502182	新垣
3	A	1985.09.13	新垣
4	B	1985.11.20	

項番	名称	指定	GRP

P6, P7

P: 個, 本, 枚, 組, 缶, 袋
S: 式
U: 組
W: ダース
M: メートル
F: フィート
G: グラム
L: リットル
Z: その他

設計	検図	査閲	承認	発行
高田	塩田		新垣	

表面	所要寸度	仕上・処理

第三角法	尺度 /	特に指定なきは社内普通公差とす。

現仕様

G9WZS
PCB
ASSEMBLY

E136-433272-B

NEC

日本電気株式会社